

股票代號：3374

精材科技股份有限公司

Xintec Inc.

民國一一四年度年報

中華民國一一五年三月三十一日 刊印

台灣證券交易所公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

精材公司年報網址：<http://www.xintec.com.tw>

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人

姓名：林恕敏

職稱：副總經理

電話：(03) 433-1818

電子郵件信箱：invest@xintec.com.tw

代理發言人

姓名：馬中文

職稱：協理

電話：(03) 433-1818

電子郵件信箱：invest@xintec.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

1. 總公司：

桃園市中壢區吉林路 23 號 9 樓

電話：(03) 433-1818

2. 工廠：

Line-A：桃園市中壢區吉林路 25 號 電話：(03) 433-1818

Line-B：桃園市中壢區自強二路 1 號 電話：(03) 433-1818

Line-C：桃園市中壢區中園路 188 號 電話：(03) 433-1818

三、辦理股票過戶機構：

名稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市建國北路一段 96 號地下一樓

網址：<https://www.tssco.com.tw/>

電話：(02) 2504-8125

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：陳彥君、林心彤

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市松仁路 100 號 20 樓

網址：<https://www.deloitte.com/tw>

電話：(02) 2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所：無。

六、公司網址：<http://www.xintec.com.tw>

## 目錄

	<u>頁次</u>
壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告	
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	3
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金.....	10
三、公司治理運作情形.....	14
四、會計師公費資訊.....	45
五、更換會計師資訊.....	46
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會 計師所屬事務所或其關係企業之期間.....	47
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之 十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	47
八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊.....	48
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	48
參、募資情形	
一、股本來源.....	49
二、主要股東名單.....	52
三、公司股利政策及執行狀況.....	52
四、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響.....	53
五、員工分紅及董事、監察人酬勞.....	53
六、公司買回本公司股份情形.....	53
七、公司債、特別股、海外存託憑證及併購之辦理情形.....	53
八、員工認股權憑證辦理情形.....	53
九、限制員工權利新股.....	53
十、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	53
十一、資金運用計畫執行情形.....	53
肆、營運概況	
一、業務內容.....	54
二、市場及產銷概況.....	60
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均 年齡及學歷分布比率.....	72
四、環保支出資訊.....	72
五、勞資關係.....	72
六、資通安全管理.....	74

七、重要契約.....	77
伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項	
一、財務狀況.....	78
二、財務績效.....	79
三、現金流量.....	80
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	81
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫.....	81
六、風險事項.....	81
七、其他重要事項.....	83
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料.....	84
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	84
三、最近年度及截至年報刊印日止，發生證交法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	84
四、其他必要補充說明事項.....	84

# 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

民國 114 年為全球經濟步入「後通膨、高科技競爭」的關鍵轉折點，整體經濟環境呈現平穩但成長動能分化的格局。台灣半導體產業憑藉堅實的技術壁壘，成功於貿易戰中化危機為轉機，然企業面臨「能源、人力、減碳、關稅」四重成本的夾擊。隨著工業電費上修、碳費時代正式開啟、加之結構性缺工引發的薪資調升，多重因素正嚴峻考驗企業的獲利韌性。

精材 114 年營運表現，在 3D 感測元件封裝業務，受到客戶分散供應鏈影響，訂單顯著下滑。加上晶圓測試新廠開辦費及初期高營運成本的影響，上半年毛利表現一度承壓；下半年測試業務在產能順利開出及滿意的稼動率帶動下，營業淨利的表現較上半年大幅改善。總結全年整體營收雖略有增長，惟受到高毛利訂單衰退的影響，獲利表現則不如前一年度。

## 經營實績

公司 114 年全年營收為新台幣 72.4 億元，較前一年營收增加 2.5%。淨利為新台幣 13.5 億元，較前一年度減少 18.9%。每股淨利為新台幣 4.99 元。財務收支及獲利能力分析如下：

單位:新台幣佰萬元

分析項目		114年度	113年度	增減比率	
財務 收支	營業收入	7,239	7,060	2.5%	
	營業毛利	1,985	2,493	-20.4%	
	稅後淨利	1,354	1,670	-18.9%	
獲利 能力	資產報酬率(%)	9.79%	14.66%	-4.9%	
	股東權益報酬率(%)	14.36%	19.59%	-5.2%	
	占實收資本比率(%)	營業利益	58.63%	72.81%	-14.2%
		稅前利益	57.67%	75.93%	-18.3%
	純益率(%)	18.70%	23.65%	-5.0%	
稅後基本每股盈餘(元)	4.99	6.15	-18.9%		

## 技術與創新

精材科技針對先進技術，持續逐年投資，並依據市場趨勢與特定客戶未來需求，發展各項晶圓級封裝與技術服務。例如穿戴裝置、AR 智慧眼鏡相關應用、車用電子產品等，開發各項先進加工技術與系統級整合封裝(System in Package, SiP)，提供客戶產品效能提升的封裝解決方案。

114 年 12 吋新機台逐步到位，各項新專案開發陸續進行，應用包括車用 CIS、穿戴裝置感測器等客製化 CSP 封裝，其中數項已經完成產品驗證，今年起將逐步量產。

#### 企業治理與社會責任

我們深知企業的韌性建立在永續經營的基礎上。精材科技積極響應利害關係人對 ESG 的關注，並將氣候變遷、人權價值及勞工權益等重要議題納入長期發展策略。透過技術創新與綠色供應商的協作，在創造商業價值的同時實現環境共好。公司去年如期達成年度推行「123 專案」，節能 1%、減少廢棄物 2%、降低用水 3% 的環境管理目標。回顧專案推動 10 年的成果，以營收為基準的減碳、減廢及節水三大指標，改善幅度均已突破 50%。對於再生能源使用計畫，今年將再增購 640 萬度，達年度 940 萬度的目標。

公司堅持建構尊重人權、多元、平等、包容、安全與環保的工作環境，去年再次通過責任商業聯盟 (RBA) 的稽核及職安衛相關精進措施的認證。公司除了例行舉辦廠區愛心義賣、募集物資、善款捐助弱勢團體、去年起又擴大兒福機構學童獎學金活動，激勵孩子們不因困於環境弱勢，積極努力向學。去年相關捐助金額達新台幣 130 萬元，讓愛走進社會已是精材同仁熱心參與公益的日常。

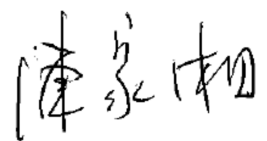
#### 前景與展望

面對大環境挑戰，本公司將採取差異化策略，聚焦於具備利基優勢之晶圓級 CSP (Chip Scale Package) 封裝服務。因應客戶新一代產品研發需求，精材持續投入中長期技術研發與設備升級，精進客製化之封裝與加工能力。

展望 115 年，在晶圓測試服務業務方面將按計劃執行第二階段裝機，預期會逐季貢獻營收，將是新一年裡公司最主要的成長動能。此外，8 吋 CSP 產線將有數項新專案放量生產，可提升產能利用率及獲利能力。同時第三季完成 12 吋 CSP 產能擴充達每月 2 千片。配合客戶時程，順利進行各項新專案產品量產是精材今年最重要的工作。

最後，誠摯感謝各位利害關係人長期對精材科技的支持與厚愛，與我們共創永續發展的未來。

董事長暨總經理 陳家湘



## 貳、 公司治理報告

### 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

#### (一) 董事及監察人資料

##### 1. 董事及監察人資料

115 年 3 月 30 日

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	初次選 任日期	選任 日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持 有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管 、董事或監察人			備註
							股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	陳家湘(註1)	男 61~70歲	106/6/30	114/5/29	3年	0	0	200,000	0.07	0	0	0	0	台積公司先進封測三廠資深處長 台積固態照明公司總經理 台積太陽能公司總經理 台積公司上海松江廠總經理 台積公司三廠廠長 新加坡 SSMC 合資廠營運副總 台積公司產品工程處處長 台積公司七廠廠長 交通大學光電工程研究所碩士 交通大學電子物理系學士	本公司總經理及 ESG 指導委員會召集人	無	無	無	
	中華民國	台灣積體電路製造股份有限公司代表人		96/3/5	114/5/29	3年	111,281,925	41.01	111,281,925	41.01	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
董事	中華民國	游秋山	男 61~70歲	113/11/8	114/5/29	3年	0	0	0	0	0	0	0	0	台積公司歐亞業務副總經理 台積公司歐亞業務策略客戶專案辦公室資深處長 台積公司電子東作處資深處長 台積公司 SRAM/DRAM/嵌入式 DRAM 開發處副處長 美國伍斯特理工學院化學工程博士	台積公司特殊技術組織副總經理	無	無	無	
	中華民國	台灣積體電路製造股份有限公司代表人		96/3/5	114/5/29	3年	111,281,925	41.01	111,281,925	41.01	0	0	0	0	-	-	-	-	-	

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	初次選 任日期	選任 日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持 有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管 、董事或監察人			備註
							股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)			職稱	姓名	關係	
獨立 董事	中華 民國	王文字	男 71-80 歲	102/6/13	114/5/29	3 年	0	0	0	0	0	0	0	0	創意電子公司獨立董事 凱基證券獨立董事 統一超商公司獨立董事 臺灣大學法律學院教授 開南大學法律學院客座教授兼院長 行政院公平交易委員會委員 美國史丹福大學法學博士	本公司薪酬委員會委員 尼得科超眾科技獨立董事 臺灣大學法律學院兼任教授 國際比較法學會(IACL)台灣分會召集人	無	無	無	
獨立 董事	中華 民國	謝徽榮	男 71-80 歲	102/6/13	114/5/29	3 年	0	0	0	0	0	0	0	0	茂達電子股份有限公司獨立董事 寶勝國際(控股)有限公司獨立非執行 董事 世界先進積體電路股份有限公司財務 副總經理 美商美國銀行台北分行副總經理 臺灣大學商研所碩士 清華大學核子工程系學士	本公司審計委員會召集人及薪酬委員會 委員	無	無	無	
獨立 董事	中華 民國	梁明成	男 61-70 歲	112/5/29	114/5/29	3 年	0	0	0	0	0	0	0	0	昇陽國際半導體獨立董事 台灣光罩集團美祿科技董事 建騰創達科技獨立董事 美光科技副總裁 台灣大學國際企業學系研究所 EMBA 碩士 成功大學物理系學士	本公司 ESG 指導委員會委員及 薪酬委員會召集人 昇陽國際半導體董事長	無	無	無	
獨立 董事	中華 民國	李雨師(註 2)	女 41-50 歲	114/5/29	114/5/29	3 年	0	0	0	0	0	0	0	0	中原大學領導力發展中心暨EMBA副 執行長 中原大學公共事務中心主任 中原大學企業管理學系助理教授 政治大學企業管理博士	本公司 ESG 指導委員會委員 中原大學學生事務處副學務長及中原 大學企業管理學系副教授	無	無	無	

註1：本公司董事長陳家湘先生為法人董事台灣積體電路製造股份有限公司之代表人，陳家湘先生經董事會任命為總經理。6席董事中僅1席具兼任經理人身份，4席為獨立董事，符合過半數董事未具員工或經理人之規定。依109年1月2日發佈之「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，上櫃公司董事長與總經理或相當職務者為同一人者，應於112年12月31日前設置獨立董事人數不得少於4人。本公司已於112年5月29日增選一席獨立董事。

註2：李雨師董事於114年5月29日股東會選任為獨立董事，溫環岸董事任期至該次股東常會(114年5月29日)完成時止。

## 2.法人股東之主要股東

法人名稱	法人之主要股東	持股比
台灣積體電路製造股份有限公司 (註 1)	花旗託管台積電存託憑證專戶	20.49%
	行政院國家發展基金管理會 代表人：葉俊顯	6.38%
	花旗(台灣)商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶	2.08%
	花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	1.81%
	中國信託商業銀行受託保管元大台灣卓越50證券投資信託基金專戶	1.61%
	渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	1.37%
	渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	1.27%
	新制勞工退休基金	1.20%
	渣打託管 iShares 新興市場 ETF	0.97%
	渣打國際商業銀行營業部受託保管歐洲太平洋基金投資專戶	0.71%

註1：基準日為114年12月17日。

## 3. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東：不適用

4. 董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
台灣積體電路製造股份有限公司 代表人：陳家湘	具商務及公司業務所須之五年以上工作經驗，且無公司法第三十條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料。	1.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	無
台灣積體電路製造股份有限公司 代表人：游秋山	具商務及公司業務所須之五年以上工作經驗，且無公司法第三十條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料。	1.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	無
王文宇	具法務及公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上之五年以上工作經驗，且無公司法第三十條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料。	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務且取得報酬。	1
謝徽榮	具財務、會計及公司業務所須之五年以上工作經驗，且無公司法第三十條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料。	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務且取得報酬。	0
梁明成	具商務及公司業務所須之五年以上工作經驗，且無公司法第三十條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務且取得報酬。	0
李雨師	具公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上之五年以上工作經驗，且無公司法第三十條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料。	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務且取得報酬。	0

## 5. 董事會多元化及獨立性：

### (1) 董事會多元化：

#### 董事會多元化政策：

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員宜普遍具備執行職務所需之知識、技能及素養，如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力等。獨立董事之選任，宜考量其成員是否具備誠信踏實、公正判斷、專業知識、豐富之經驗與閱讀財務報表能力等條件。

本公司獨立董事之資格及選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。本公司董事之選任，依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

除以上多元化政策外，本公司董事會多元化目標為獨立董事席次過半及至少包含一名女性董事。

### (2) 董事會多元化管理目標與目前達成情形：

董事會成員目前已達成多元化的要求；未來於董事改選提名時，將持續考量公司長期發展目標、董事專業的互補性等；或透過董事課程等訓練，以強化董事會成員多元化之目標。另外，本公司董事會女性董事席次雖未達三分之一，董事會成員之組成主要考量董事專業背景、互補性及對公司未來發展的參與度及貢獻度等，並未特別設限性別比例，但未來仍將盡力促進董事會成員之性別平等，將不同性別董事達三分之一設定為長期目標。

### (3) 董事會成員多元化落實情形：

本公司現任董事會由六位董事組成，其中獨立董事為四席，超過半數，且六位董事間不具有配偶及二等親以內親屬關係，因此本公司董事會具獨立性。董事長陳家湘先生兼任本公司總經理，亦符合兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一規定。另外，六位董事中包含一位女性董事。本公司董事會成員具備跨產業領域之多元互補能力，也各自具有產業經驗與相關技能，如法律、財務會計、產業科技研發、經營管理、永續管理、專業技能及產業經歷，本公司個別董事落實董事會成員多元化政策之情形如下：

董事 姓名	多 元 化 核 心 項 目									
	性別	國籍	年齡	年資	經營管理	領導決策	產業知識	財會專業	法律專業	永續管理
陳家湘	男	中華民國	61~70歲	6-9年	✓	✓	✓			
游秋山	男	中華民國	61~70歲	1年以上	✓	✓	✓			
王文宇	男	中華民國	71~80歲	12年以上	✓	✓			✓	
謝徽榮	男	中華民國	71~80歲	12年以上	✓	✓		✓		
梁明成	男	中華民國	61~70歲	2年以上	✓	✓	✓			
李雨師	女	中華民國	41~50歲	1年以下	✓	✓				✓

(4)董事會獨立性：

本公司現任董事會由6位董事組成，其中包含4位獨立董事成員(佔66.7%)，並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，且董事間並無配偶及二親等以內親屬關係之情形。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

115 年 3 月 30 日

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司 之職務	具配偶或二親等以內關係之 經理人			備註
					股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職 稱	姓 名	關 係	
總 經 理	中華民國	陳家湘	男	106/7/1	200,000	0.07	0	0	0	0	台積公司先進封測三廠資深處長 台積固態照明公司總經理 台積太陽能公司總經理 台積公司上海松江廠總經理 台積公司三廠廠長 新加坡 SSMC 合資廠營運副總 台積公司產品工程處處長 台積公司七廠廠長 交通大學光電工程研究所碩士 交通大學電子物理系學士	無	無	無	無	註 1
財 務 組 織 副 總 經 理	中華民國	林恕敏	男	91/5/1	52,629	0.02	0	0	0	0	致福電子(股)公司會計經理 敦南科技(股)公司會計主任 東吳大學會計系學士	無	無	無	無	
支 援 組 織 協 理	中華民國	范振梅	男	108/8/2	16,787	0.01	0	0	0	0	本公司中壢廠區資深廠長/支援組織資深處長 台積公司副理 臺灣工業技術學院電機工程技術系學士	無	無	無	無	
研 發 組 織 協 理	中華民國	劉滄宇	男	108/8/2	20,025	0.01	0	0	0	0	本公司研發組織/資深處長 台積公司副理 臺灣大學化學研究所碩士	無	無	無	無	
營 運 組 織 協 理	中華民國	藍和谷	男	113/4/19	0	0	0	0	0	0	本公司 Line A/B 廠/資深廠長 台積公司經理 交通大學電子物理研究所碩士	無	無	無	無	
業 務 組 織 協 理	中華民國	馬中文	男	111/11/4	0	0	0	0	0	0	本公司品質及可靠性組織/資深處長 本公司業務組織/資深處長 台積公司副理 美國密蘇里大學工業工程學系碩士	無	無	無	無	
法務處處長暨 公司治理主管	中華民國	周正德	男	109/8/4	5	0.00	0	0	0	0	冠群專利商標/合夥人 將群智權事務所/專利經理 東吳大學法律學系學士	無	無	無	無	

註 1：本公司董事長陳家湘先生為法人董事台灣積體電路製造股份有限公司之代表人，陳家湘先生經董事會任命為總經理。6 席董事中僅 1 席具兼任經理人身份，4 席為獨立董事，符合過半數董事未具員工或經理人之規定。依 109 年 1 月 2 日發佈之「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，上櫃公司董事長與總經理或相當職務者為同一人者，應於 112 年 12 月 31 日前設置獨立董事人數不得少於 4 人。本公司已於 112 年 5 月 29 日增選一席獨立董事。

## 二、最近年度(114)給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

### (一) 董事之酬金

114年12月31日 單位：新台幣仟元；千股

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及稅後純益之比例		有無領取子公司以外轉投資事業或公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註1)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司			本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司				
										現金金額	股票金額					現金金額	股票金額					
董事長	陳家湘 台灣積體電路製造(股)公司代表人	0	0	0	0	1,008	1,008	120	120	1,128 / 0.08%	1,128 / 0.08%	5,516	5,516	0	0	2,640	0	2,640	0	9,284 / 0.68%	9,284 / 0.68%	無
董事	游秋山 台灣積體電路製造(股)公司代表人	0	0	0	0	1,008	1,008	120	120	1,128 / 0.08%	1,128 / 0.08%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128 / 0.08%	1,128 / 0.08%	無
獨立董事	王文宇	1,008	1,008	0	0	0	0	120	120	1,128 / 0.08%	1,128 / 0.08%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128 / 0.08%	1,128 / 0.08%	無
獨立董事	謝徽榮	1,008	1,008	0	0	0	0	120	120	1,128 / 0.08%	1,128 / 0.08%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128 / 0.08%	1,128 / 0.08%	無
獨立董事	溫環岸(註2)	412	412	0	0	0	0	50	50	462 / 0.03%	462 / 0.03%	0	0	0	0	0	0	0	0	462 / 0.03%	462 / 0.03%	無
獨立董事	梁明成	1,008	1,008	0	0	0	0	120	120	1,128 / 0.08%	1,128 / 0.08%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128 / 0.08%	1,128 / 0.08%	無
獨立董事	李雨師(註2)	596	596	0	0	0	0	80	80	676 / 0.05%	676 / 0.05%	0	0	0	0	0	0	0	0	676 / 0.05%	676 / 0.05%	無

\*除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註1：陳家湘、及游秋山為台積公司代表人，董事酬勞係由其所代表之法人股東領取。

註2：李雨師董事於114年5月29日股東會選任為獨立董事，溫環岸董事任期至該次股東常會(114年5月29日)完成時止。

註3：本公司獨立董事之報酬係依本公司章程及本公司「董事酬勞、報酬及車馬費給付辦法」之規定辦理。董事會依獨立董事對公司營運參與程度及貢獻之價值，暨國內外業界水準後定之。本公司給付獨立董事每人每月報酬及車馬費。

註4：除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

### (二) 監察人之酬金

業於102年6月13日由全體獨立董事組成審計委員會並取代監察人，故不適用。

(三) 總經理及副總經理之酬金

114年12月31日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B) (註1)		獎金及特支費等 等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四 項總額及占稅後純 益之比例(%)		有無領取來自 子公司以外轉 投資事業或母 公司酬金
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報 告內所 有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	陳家湘	25,922	25,922	648	648	1,844	1,844	10,938	0	10,938	0	39,352 / 2.9%	39,352 / 2.9%	無
副總經理	林恕敏													
協理	范振梅													
協理	劉滄宇													
協理	藍和谷													
協理	馬中文													
處長暨公司 治理主管	周正德													

註1：退職退休金金額全數為提列提撥數，並無實際支付數。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	馬中文、周正德	馬中文、周正德
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	陳家湘、林恕敏、范振梅、 劉滄宇、藍和谷	陳家湘、林恕敏、范振梅、 劉滄宇、藍和谷
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總 計	7 人	7 人

(四) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元

	職 稱	姓 名	股 票 金 額	現 金 金 額	總 計	總額占稅後純 益之比例 (%)
經 理 人	總經理	陳家湘	0	10,938	10,938	0.8%
	副總經理	林恕敏				
	協理	范振梅				
	協理	劉滄宇				
	協理	藍和谷				
	協理	馬中文				
	處長暨公司治理 主管	周正德				

(五) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

本公司 113 年度及 114 年度支付董事及監察人之酬金分別為 6,778 仟元及 6,778 仟元，其佔 113 年度及 114 年度稅後淨利比例分別為 0.4% 及 0.5%。本公司 113 年度及 114 年度支付總經理及副總經理之酬金分別為 45,241 仟元及 39,352 仟元，佔 113 年度及 114 年度稅後淨利比例分別為 2.7% 及 2.9%。

2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

(1) 依公司章程規定，公司如有獲利，提撥不高於百分之二為董事酬勞，且董事酬勞給付之對象不包括擔任本公司經理人之董事。本公司董事之報酬係依本公司「董事酬勞、報酬及車馬費給付辦法」給付之，且董事報酬給付政策係以其對公司營運參與程度及貢獻價值，依據「董事會績效評估辦法」定期評估董事績效，評核範圍包括：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內

部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六項指標評估結果納入考量，暨參考國內外業界水準後訂定，並經薪資報酬委員會審議及董事會通過。

(2)本公司依公司章程規定，如有獲利提撥不低於百分之一為員工酬勞，本公司經理人之薪資報酬視其個人對本公司營運參與程度、個人績效貢獻與目標達成情況、職務、職級等因素而訂，評估項目如：目標達成率、獲利率、營運效益及貢獻度等綜合考量後，參酌市場同業水準訂定原則，經薪資報酬委員會審議及董事會通過後執行。

綜合以上，本公司給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險有一定之關聯性。

### 3.定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構：

本公司定期檢討董事及經理人績效評估，薪資報酬委員會於每年第四季報告及討論當年度董事會績效評估作業方式，於年度結束後進行評核，次年度第一季之薪資報酬委員會說明董事會績效評估結果，並於董事會中報告。

經理人之績效評估，於每年第四季由總經理依管理權責作成次年度之經理人績效目標及考核表，經薪資報酬委員會及董事會同意後，於次年度結束後進行考核，於每年第一季薪資報酬委員會中報告及檢視經理人績效評估結果。

薪資報酬委員會每年定期審議董事及經理人績效評估及薪資報酬情形，請參閱薪資報酬委員會開會資訊。

### 三、公司治理運作情形

#### (一) 董事會運作情形：

本公司董事會於 114 年度共召開 6 次(A)董事會，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出席(列)席率(%) (B/A)	備註
董事長	陳家湘 台灣積體電路製造股份有限公司 代表人	6	0	100%	
董事	游秋山 台灣積體電路製造股份有限公司 代表人	4	2	67%	
獨立董事	王文宇	6	0	100%	
獨立董事	謝徽榮	6	0	100%	
獨立董事	溫瓊岸	2	1	67%	於 114.5.29 股東會全面改選 董事後屆滿
獨立董事	梁明成	5	1	83%	
獨立董事	李雨師	3	0	100%	於 114.5.29 股東會全面改選 董事後任職

其他應記載事項：

1. 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

開會日期 (期別)	議案內容	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
114 年 2 月 6 日 (第十屆第十四次)	1. 核准本公司 113 年度董事酬勞及報酬及 114 年度董事報酬及酬勞政策。 2. 核准本公司具董事身份之經理人及經理人之 113 年第二次特別激勵獎金。 3. 核准本公司具董事身分之經理人及經理人 113 年度之績效評估及 114 年度薪資調整。 4. 核准本公司具董事身分之經理人及經理人 113 年度之員工酬勞。 5. 核准本公司具董事身分之經理人及經理人 113 年度薪資報酬及 114 年度薪資報酬政策。 6. 核准本公司修訂公司章程。 7. 核准資本支出預算合計不超過美金 3,800,000 元整購置機台。 8. 核准本公司與台積公司簽訂契約。 9. 核准 114 年度本公司向關係人台積公司進行銷貨、勞務或技術服務交易，金額不超過美元 2 億元。 10. 配合會計師事務所內部輪調需要，本公司參考審計品質指標 (AQIs) 對簽證會計師進行評估。經評估後，勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞與林心彤會計師均符合獨立性及適任性要求，核准委任其擔任簽證會計師。	無	無
114 年 4 月 15 日 (第十屆第十五次)	1. 核准解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。	無	無
114 年 5 月 8 日 (第十屆第十六次)	1. 核准維持本公司董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 2. 核准維持本公司具董事身分之經理人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。	無	無
114 年 8 月 7 日 (第十一屆第二次)	1. 核准本公司修訂「公司治理實務守則」。 2. 核准資本支出預算合計不超過美金 4,100,000 元整購置機台。	無	無

	3. 核准 114 年度委任勤業眾信聯合會計師事務所簽證服務公費由新台幣 2,970,000 元調整為新台幣 3,150,000 元。		
114 年 11 月 7 日 (第十一屆第三次)	1. 配合會計師事務所內部輪調需要，本公司參考審計品質指標 (AQIs) 對簽證會計師進行評估。經評估後，勤業眾信聯合會計師事務所陳彥君與林心彤會計師均符合獨立性及適任性要求，核准委任其擔任簽證會計師。 2. 核准 115 年度委任勤業眾信聯合會計師事務所簽證服務公費為新台幣 3,270,000 元。 3. 核准本公司具董事身份之經理人及經理人之 114 年特別激勵獎金。 4. 核准修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」。	無	無

(2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

2. 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因及參與表決情形：

- (1) 114 年 2 月 6 日召開第十屆第十四次董事會決議核准本公司 113 年度董事報酬及酬勞及 114 年度董事報酬及酬勞政策，因關係到各董事自身利益，討論及決議時，已依法各自迴避，其他全體出席董事同意照案通過。
- (2) 114 年 2 月 6 日召開第十屆第十四次董事會決議核准本公司具董事身份之經理人及經理人之 113 年第二次特別激勵獎金，因關係到董事長暨總經理陳家湘先生自身利益，討論及決議時已依法迴避，其他全體出席董事同意照案通過。
- (3) 114 年 2 月 6 日召開第十屆第十四次董事會決議核准本公司具董事身分之經理人及經理人 113 年度之績效評估及 114 年度薪資調整，因關係到董事長暨總經理陳家湘先生自身利益，討論及決議時已依法迴避，其他全體出席董事同意照案通過。
- (4) 114 年 2 月 6 日召開第十屆第十四次董事會決議核准本公司具董事身分之經理人及經理人 113 年度之員工酬勞，因關係到董事長暨總經理陳家湘先生自身利益，討論及決議時已依法迴避，其他全體出席董事同意照案通過。
- (5) 114 年 2 月 6 日召開第十屆第十四次董事會決議核准本公司具董事身分之經理人及經理人 113 年度薪資報酬及 114 年度薪資報酬政策，因關係到董事長暨總經理陳家湘先生自身利益，討論及決議時已依法迴避，其他全體出席董事同意照案通過。
- (6) 114 年 2 月 6 日召開第十屆第十四次董事會決議核准本公司與台積公司簽訂契約，因本案交易相對人台積公司為本公司之法人董事，台積公司法人董事代表陳家湘及游秋山為免利益衝突之疑慮，討論及決議時已依法迴避，其他全體出席董事同意照案通過。
- (7) 114 年 2 月 6 日召開第十屆第十四次董事會決議核准核准 114 年度本公司向關係人台積公司進行銷貨、勞務或技術服務交易，金額不超過美元 2 億元，因本案交易相對人台積公司為本公司之法人董事，台積公司法人董事代表陳家湘及游秋山為免利益衝突之疑慮，討論及決議時已依法迴避，其他全體出席董事同意照案通過。
- (8) 114 年 4 月 15 日召開第十屆第十五次董事會決議核准解除新任董事及其代表人之競業禁止限制，並提請股東會通過，因關係到各相關董事自身利益，討論及決議時，已依法各自迴避，其他全體出席董事同意照案通過。
- (9) 114 年 5 月 8 日召開第十屆第十六次董事會決議核准維持本公司董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，因關係到各董事自身利益，討論及決議時，已依法各自迴避，其他全體出席董事同意照案通過。
- (10) 114 年 5 月 8 日召開第十屆第十六次董事會決議核准維持本公司具董事身分之經理人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，因關係到董事長暨總經理陳家湘先生自身利益，討論及決議時已依法迴避，其他全體出席董事同意照案通過。
- (11) 114 年 11 月 7 日召開第十一屆第三次董事會決議核准本公司具董事身份之經理人及經理人之 114 年特別激勵獎金，因關係到董事長暨總經理陳家湘先生自身利益，討論及決議時已依法迴避，其他全體出席董事同意照案通過。

3. 董事會自我(或同儕)評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	114年1月1日至114年12月31日	董事會	董事會自評	對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制。
		個別董事成員	董事成員自評	公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。
		功能性委員會	功能性委員會自評	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。

4. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- (1) 本公司已於 100 年 11 月 11 日成立薪酬委員會，以協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策及經理人之報酬。
- (2) 本公司 102 年度業經股東會通過設置審計委員會，目前由四位獨立董事組成，強化董事會公司治理職能。
- (3) 本公司於 112 年 11 月設置 ESG 指導委員會，由三名董事(含兩名獨立董事)組成，主席為陳家湘先生。委員會職權包括(i)負責擬定公司 ESG 願景及策略(ii)監督 ESG 執行委員會執行狀況。因應證交所與櫃買中心實施之「上市上櫃企業社會責任實務守則」，本公司經董事長授權高階經理人擔任主任委員，於 104 年 9 月成立企業社會責任委員會(CSR Committee)，並由公司內各部門組織推派代表，包括人資、環安衛、業務、設計開發、法務、廠務、採購及財會部門等跨部門成員兼職組成委員會。財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 110 年 12 月 13 日證櫃監字第 11000715832 號令，為配合國際發展趨勢，實踐永續發展之目標，強化我國上市上櫃公司推動永續發展執行情形，本公司爰修正名稱為「永續發展實務守則」，並將 CSR 委員會更名為 ESG 委員會，持續追求企業永續發展。112 年 11 月為健全監督功能及強化管理機能，經董事會核准設立 ESG 指導委員會，原 ESG 委員會更名為 ESG 執行委員會。ESG 執行委員會每季召開會議，藉各部門代表於日常業務中與利害關係人持續溝通並收集反饋資訊，落實執行各項 ESG 相關工作，並於會議中彙報與各部門間協調進度，以完成有關利害關係人之各項議題管控，落實高階經理人之承諾，促進經濟、環境與社會之間的平衡與企業永續發展之實踐。為此，精材公司訂有 ESG 政策，也將依該政策持續推動、改善以俾追求提升公司競爭力與回饋社會的理念，實踐企業應負之社會責任，並每年定期於董事會報告 ESG 實踐成果與利害關係人關注議題，董事會檢視 ESG 策略的進展，並於需要時督促 ESG 執行委員會及經營團隊進行調整。

## (二) 審計委員會運作情形

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會審議的事項主要包括：

- 財務報表；
- 稽核及會計政策與程序；
- 內部控制制度暨相關之政策與程序；
- 重大之資產或衍生性商品交易；
- 重大資金貸與背書或保證；
- 募集或發行有價證券；
- 衍生性金融商品及現金投資情形；
- 法規遵循；
- 經理人與董事是否有關係人交易及可能性；
- 申訴報告；
- 防止舞弊計畫及舞弊調查報告；
- 資訊安全；
- 公司風險管理；
- 簽證會計師資歷、獨立性及績效評估；
- 簽證會計師之委任、解任或報酬；
- 財務、會計或內部稽核主管之任免；
- 審計委員會職責履行情形。

最近年度審計委員會開會 6 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備 註
獨立董事	王文字	6	0	100%	114.5.29 續任
獨立董事	謝徽榮	6	0	100%	114.5.29 續任
獨立董事	溫環岸	2	1	67%	114.5.29 屆滿
獨立董事	梁明成	5	1	83%	114.5.29 續任
獨立董事	李雨師	3	0	100%	114.5.29 新任

其他應記載事項：

一、 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

開會日期 (期別)	議 案 內 容	獨立董事反對 意見、保留意見 或重大建議 項 目 內 容	審計委員會 決 議 結 果	公司對審計 委員會意見 之 處 理
114 年 2 月 6 日 (第四屆第十三次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 請同意本公司 113 年度之營業報告書及財務報表。</li> <li>2. 請同意本公司 113 年度之盈餘分派案。</li> <li>3. 請同意本公司修訂公司章程。</li> <li>4. 請同意資本支出預算合計不超過美金 3,800,000 元購置機台。</li> <li>5. 請同意本公司與台積公司簽訂契約，以及合議授權獨立董事王文字先生代表簽署。</li> <li>6. 本公司參考審計品質指標(AQIs)對簽證會計師進行評估。評估後，勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞會計師及林心彤會計師均符合簽證會計師獨立性及適任性要求，請同意委任蔡美貞與林心彤擔任簽證會計師。</li> <li>7. 請同意本公司 113 年度之「內部控制制度聲明書」。</li> </ol>	無	出席委員一致同意照案通過	無

114年4月15日 (第四屆第十四次)	1. 請同意解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制。	無	出席委員一致同意照案通過	無
114年5月8日 (第四屆第十五次)	1. 請同意本公司114年度第1季財務報表。	無	出席委員一致同意照案通過	無
114年5月29日 (第五屆第一次)	請依審計委員會組織規程推舉召集人及會議主席。	無	出席委員一致同意照案通過	無
114年8月7日 (第五屆第二次)	1. 請同意本公司114年度第2季財務報告。 2. 請同意資本支出預算合計不超過美金4,100,000元整購置機台。 3. 請同意本公司修訂「公司治理實務守則」。 4. 請同意本公司114年度委任勤業眾信聯合會計師事務所簽證服務公費調整。	無	出席委員一致同意照案通過	無
114年11月7日 (第五屆第三次)	1. 請同意本公司114年度第3季財務報告。 2. 本公司參考審計品質指標(AQIs)對簽證會計師進行評估。評估後，勤業眾信聯合會計師事務所陳彥君會計師及林心彤會計師均符合簽證會計師獨立性及適任性要求，請同意委任陳彥君與林心彤擔任簽證會計師。 3. 請同意本公司115年度委任勤業眾信聯合會計師事務所簽證服務公費。 4. 請同意本公司修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」。	無	出席委員一致同意照案通過	無

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

1.本公司內部稽核主管定期與審計委員會溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。

2.會計師定期與審計委員會溝通說明財務報表查核情形及其相關法令要求事項，且獨立董事得隨時要求會計師進行報告與溝通。

3.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要，請參考本公司網站：

[https://www.xintec.com.tw/chi/Legal/CG\\_Committees\\_Audit.html](https://www.xintec.com.tw/chi/Legal/CG_Committees_Audit.html)

監察人參與董事會運作情形：

本公司於102年6月13日已設置審計委員會，故不適用監察人制度。

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	√		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並於公開資訊關測站及公司網站揭露公司治理實務守則。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益				無重大差異
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	√		(一) 本公司設有發言人制度，統一由發言人或代理發言人處理股東建議、疑義及糾紛等問題。	
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√		(二) 本公司每月向董事及持股10%以上大股東取得持股變動申報書，以確實掌握實際控制公司之主要股東名單，不定期與主要股東保持密切聯繫，以掌握其最終控制者之名單。	
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√		(三) 制定及落實內部控制制度及相關管理辦法，稽核單位並定期監督執行情形。	
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√		(四) 公司訂有內部重大資訊處理作業程序，以規範內部重大資訊保密作業程序，訂定並宣導公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控制措施，包括(但不限於)不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易本公司股票。	
三、董事會之組成及職責				無重大差異
(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	√		(一) 董事會多元化政策： 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員宜普遍具備執行職務所需之知識、技能及素養，如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力等。獨立董事之選任，宜考量其成	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>員是否具備誠信踏實、公正判斷、專業知識、豐富之經驗與閱讀財務報表能力等條件。</p> <p>本公司獨立董事之資格及選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。本公司董事之選任，依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。</p> <p>董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</p> <p>一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</p> <p>二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。</p> <p>除以上多元化政策外，本公司董事會多元化目標為獨立董事席次過半及至少包含一名女性董事。</p> <p>董事會多元化管理目標與目前達成情形</p> <p>董事會成員目前已達成多元化的要求；未來於董事改選提名時，將持續考量公司長期發展目標、董事專業的互補性等；或透過董事課程等訓練，以強化董事會成員多元化之目標。</p> <p>董事會成員多元化落實情形</p> <p>本公司現任董事會由六位董事組成，其中獨立董事為四席，超過半數，且六位董事間不具有配偶及二等親以內親屬關係，因此本公司董事會具獨立性。董事長</p>

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																																																																																							
	是	否	摘要說明																																																																																								
<p>(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p> <p>(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？</p>	V	V	<p>陳家湘先生兼任本公司總經理，亦符合兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一規定。另外，六位董事中包含一位女性董事。本公司董事會成員具備跨產業領域之多元互補能力，也各自具有產業經驗與相關技能，如法律、財務會計、產業科技研發、經營管理、永續管理、專業技能及產業經歷，本公司個別董事落實董事會成員多元化政策之情形如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">董事姓名</th> <th colspan="10">多元化核心項目</th> </tr> <tr> <th>性別</th> <th>國籍</th> <th>年齡</th> <th>年資</th> <th>經營管理</th> <th>領導決策</th> <th>產業知識</th> <th>財務會計</th> <th>法律</th> <th>永續管理</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>陳家湘</td> <td>男</td> <td>中華民國</td> <td>61~70歲</td> <td>6~9年</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>游秋山</td> <td>男</td> <td>中華民國</td> <td>61~70歲</td> <td>1年以上</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>王文宇</td> <td>男</td> <td>中華民國</td> <td>71~80歲</td> <td>12年以上</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>謝徽榮</td> <td>男</td> <td>中華民國</td> <td>71~80歲</td> <td>12年以上</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>梁明成</td> <td>男</td> <td>中華民國</td> <td>61~70歲</td> <td>2年以上</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>李雨師</td> <td>女</td> <td>中華民國</td> <td>41~50歲</td> <td>1年以下</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table> <p>(二) 本公司董事會於112年11月7日核准設立「ESG指導委員會」，由三名董事(含兩名獨立董事)組成，召集人為董事長陳家湘先生。委員會職權包括(1)負責擬定公司ESG願景及策略，(2)監督ESG執行委員會執行狀況。</p> <p>(三) 本公司已建立董事會績效評估制度，董事會並於109年2月通過董事績效評估辦法，以提昇董事會功能，強化董事會運作效率。內部評估董事會整體績效自評涵蓋以下五大構面：A. 對公司營運之參與程度 B. 提升董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事之選任及持續進修 E. 內部控制。董事成員績效評估之衡量項目則涵蓋以下六大面向：A. 公司目標與任</p>	董事姓名	多元化核心項目										性別	國籍	年齡	年資	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律	永續管理	陳家湘	男	中華民國	61~70歲	6~9年	✓	✓	✓				游秋山	男	中華民國	61~70歲	1年以上	✓	✓	✓				王文宇	男	中華民國	71~80歲	12年以上	✓	✓			✓		謝徽榮	男	中華民國	71~80歲	12年以上	✓	✓		✓			梁明成	男	中華民國	61~70歲	2年以上	✓	✓	✓				李雨師	女	中華民國	41~50歲	1年以下	✓	✓				✓	
董事姓名	多元化核心項目																																																																																										
	性別	國籍	年齡	年資	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律	永續管理																																																																																	
陳家湘	男	中華民國	61~70歲	6~9年	✓	✓	✓																																																																																				
游秋山	男	中華民國	61~70歲	1年以上	✓	✓	✓																																																																																				
王文宇	男	中華民國	71~80歲	12年以上	✓	✓			✓																																																																																		
謝徽榮	男	中華民國	71~80歲	12年以上	✓	✓		✓																																																																																			
梁明成	男	中華民國	61~70歲	2年以上	✓	✓	✓																																																																																				
李雨師	女	中華民國	41~50歲	1年以下	✓	✓				✓																																																																																	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		<p>務之掌握 B.董事職責認知 C.對公司營運之參與程度 D.內部關係經營與溝通 E.董事之專業及持續進修 F.內部控制。自民國102年起每年執行一次，定期辦理董事自評與同儕互評，自112年2月起增加功能性委員會績效評估，衡量項目包含以下五大面向：A.對公司營運之參與程度 B.功能性委員會職責認知 C.提升功能性委員會決策品質 D.功能性委員會組成及成員選任 E.內部控制。評估結果於第一季檢討並提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考，民國114年度本公司內部董事會績效評估等級「優」，董事成員績效評估等級「優」，審計委員會績效評估等級「優」，薪資報酬委員會績效評估等級「優」，足以顯示本公司強化董事會效能之成果。</p> <p>(四) 本公司每年依據審計品質指標(AQIs)定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，要求簽證會計師每年提供「超然獨立聲明書」外，另製作「會計師獨立性及適任性評估表」，針對可能影響獨立性項目逐一評估簽證會計師之獨立性，經本公司確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他財務利益及業務關係；會計師家庭成員亦不違反獨立性的要求，認為符合獨立性及適任性之要求，並提報審計委員會及董事會討論通過。</p>	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董	V		本公司董事會於 109 年 8 月 4 日決議通過任命法務處處長周正德先生為公司治理主管。本公司所有董事皆可取得公司治理主管之協助，以確保董事會程序及所有適用法令、規則均獲得遵守，並確保董事會成員之間及董事與經理部門之間資	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因										
	是	否	摘要說明											
事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？			<p>訊交流良好。</p> <p>本公司公司治理主管已具備公開發行公司從事法務之主管經驗達三年以上。</p> <p>本公司董事會指定議事事務單位由董事會秘書單位負責，由財務組織副總經理林恕敏先生擔任董事會秘書。董事會秘書單位負責統籌提供董事執行業務所需資料及公司治理相關事務，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。</li> <li>二、製作董事會及股東會議事錄。</li> <li>三、協助董事、獨立董事就任及持續進修。</li> <li>四、提供董事、獨立董事執行業務所需之資料。</li> <li>五、協助董事、獨立董事遵循法令。</li> <li>六、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章。</li> <li>七、辦理董事異動相關事宜。</li> <li>八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</li> </ol> <p>年度公司治理業務執行情形彙整如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜</th> <th>協助董事就任及完成持續進修時數</th> <th>協助董事遵循法令及執行職務</th> <th>辦理公司登記及變更登記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114</td> <td>6次董事會，1次股東會</td> <td>48小時</td> <td>每季評估內部程序或辦法是否符合法規要求。修訂「公司治理實務守則」、「公司章程」、「內部控制制度」及「內部稽核制度」。</td> <td>完成公司變更登記1次</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司參加105年至110年及112年主管機關之公司治理評鑑結果，均列於前5%。111年及113年則列於6~10%。</p>	年度	依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜	協助董事就任及完成持續進修時數	協助董事遵循法令及執行職務	辦理公司登記及變更登記	114	6次董事會，1次股東會	48小時	每季評估內部程序或辦法是否符合法規要求。修訂「公司治理實務守則」、「公司章程」、「內部控制制度」及「內部稽核制度」。	完成公司變更登記1次	
年度	依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜	協助董事就任及完成持續進修時數	協助董事遵循法令及執行職務	辦理公司登記及變更登記										
114	6次董事會，1次股東會	48小時	每季評估內部程序或辦法是否符合法規要求。修訂「公司治理實務守則」、「公司章程」、「內部控制制度」及「內部稽核制度」。	完成公司變更登記1次										

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	√		本公司設有發言人及代理發言人擔任公司對外溝通管道，並於公司網站設置違反從業道德行為舉報系統，提供客戶、廠商或其他利害關係人檢舉本公司人員不當行為之管道。 為確保各項重大性議題之落實及目標達成情形，ESG執行委員會定期蒐集檢視利害關係人所關切議題，每年定期將各利害關係人溝通情形向董事會報告，並揭露於利害關係人專區。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	√		本公司已委任台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	無重大差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等) (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	√ √ √		(一) 本公司已架設公司中英文網站，並責成相關部門維護及揭露公司財務業務等相關資訊。 (二) 本公司已指定專人負責定期及不定期於公開資訊觀測站申報各項財務業務資訊並依相關規定發佈重大訊息，並設有發言人及代理發言人制度，公司亦將定期召開法人說明會之簡報及影音檔放置於公司網站。 (三) 本公司年度財務報告均於會計年度終了後兩個月內公告並申報，第一、二、三季財務報告及各月份營運情形均於規定期限前提早公告。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	√		(一) 在環境保護方面，遵守環保、安全與綠色產品等永續發展相關之法令規章或要求，並持續關注國際環保發展趨勢，強化綠色環保責任，並致力規劃與執行各項節能減碳專案，以減少各項用電及溫室效應氣體排放量，降低地球溫室氣體效應，善盡地球公民職責。 (二) 在勞動權益方面，持續改善就業環境與安全衛生管理制度，以提供平等就業機會及預防傷害事故與職業疾病的發生。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>(三) 在員工權益方面，設置多元員工溝通管道，建立順暢工作環境、成立職工福利委員會、實施退休金制度、辦理員工團體保險及定期舉辦健康檢查，並提供各項員工訓練課程等持續進修管道。</p> <p>(四) 在供應商管理方面，本公司設有供應商考核制度確保供應商能符合本公司的品質及環境政策，訂有供應商評鑑制度以確保稽核之執行，並與供應商維持順暢的溝通管道，保持良好的上下游關係，促進產業鏈永續發展。</p> <p>(五) 在資訊保密方面，尊重與保護客戶之技術文件與資料。對外，本公司與客戶及供應商簽有保密協議，明訂具法律效力的權利及義務；對內，本公司設有機密資訊保護委員會，要求員工遵守相關保密規定，並落實保安全管理，以保障公司及客戶之機密資訊安全。</p> <p>(六) 本公司依法令規定公開公司資訊，以保障投資人及利害關係人之權利。</p> <p>(七) 本公司每年舉辦董事進修相關課程，雖未強制要求董事進修專業知識課程，但係以積極態度鼓勵董事依個人需求參與。</p> <p>(八) 本公司為落實公司治理，已為本公司董事投保責任保險。</p>	
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。</p> <p>(一) 茲就最近年度公司治理評鑑結果已改善項目包括： 為確保關係人交易不損害公司利益或股東權益，特訂定與關係人相互間之財務業務相關作業之書面規範；以及確保董事會在履行其審查、監督和指導治理實務、揭露、策略、風險管理及內部控制時充分考慮重大永續風險與機會，公司永續報告書提報董事會討論決議。</p> <p>(二) 針對尚未改善者加強事項與改善措施說明如下： 強化員工定期溝通對話之管道，讓員工對於公司之經營管理活動和決策，有獲得資訊及表達意見之權利。</p>				

(四) 公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

薪資報酬委員會：

- 1.組成：本公司於 100 年 11 月 11 日成立薪酬委員會，並於 114 年 5 月 29 日改選後由梁明成先生(召集人)、王文宇先生及謝徽榮先生三位獨立董事組成薪酬委員會。

身分別	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
	姓名			
獨立董事	梁明成	(註一)	(註一)	0
獨立董事	王文宇	(註一)	(註一)	0
獨立董事	謝徽榮	(註一)	(註一)	0

註一：參閱第 6 頁董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊之揭露。

2.職權範圍：

- (1)定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
- (2)定期評估並訂定公司整體薪酬政策。
- (3)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- (4)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- (1)董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- (2)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- (3)針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊：

- (1)本公司之薪資報酬委員會委員共計三人，每年至少開會 2 次。
- (2)本屆委員任期：114 年 5 月 29 日至 117 年 5 月 28 日，114 年度薪資報酬委員會共開會 4 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
召集人	梁明成	2	0	100%	任期自 114.5.29 起當選薪資報酬委員會召集人
委員	王文宇	3	1	75%	
委員	謝徽榮	4	0	100%	
委員	溫環岸	2	0	100%	任期至 114.5.29 全面改選後辭任

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

4.薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：


開會日期	項次	議案內容及後續處理
114年2月6日 第五屆第八次	一	審議訂定本公司基層員工薪資水準及調整整體薪酬制度，並提請董事會決議。
	二	審議本公司提撥113年度員工酬勞案，並提請董事會決議。
	三	審議本公司113年度董事報酬及酬勞及114年度董事報酬及酬勞政策案，並提請董事會決議。
	四	審議本公司具董事身份經理人及經理人113年第二次特別激勵獎金，並提請董事會決議。
	五	審議本公司具董事身份經理人及經理人之113年度績效評估及114年度薪資調整案，並提請董事會決議。
	六	審議本公司具董事身份經理人及經理人之113年度員工酬勞，並提請董事會決議。
	七	審議本公司具董事身份經理人及經理人之113年度薪資報酬及114年度薪資報酬政策案，並提請董事會決議。
		薪酬委員會決議結果：除第三案各委員於有自身利害關係之事項皆已迴避，其餘委員會全體成員同意通過。
		公司對於薪酬委員會成員意見之處理：除第四案、第五案、第六案及第七案因陳家湘董事長涉及自身利害關係之事項，自行迴避討論及表決，第三案各委員於有自身利害關係之事項皆已迴避，所有議案經出席之董事一致無異議依薪資報酬委員會之建議通過。
114年5月8日 第五屆第九次	一	檢討本公司董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並提請董事會決議。
	二	檢討本公司具董事身分之經理人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並提請董事會決議。
		薪酬委員會決議結果：委員會全體成員同意通過。
		公司對於薪酬委員會成員意見之處理：經出席之董事一致無異議依薪資報酬委員會之建議通過。
114年5月29日 第六屆第一次	一	推舉第六屆薪資報酬委員會召集人及會議主席。
		薪酬委員會決議結果：經討論後，全體出席委員無異議一致推舉梁明成委員擔任第六屆薪資報酬委員會召集人及會議主席。
		公司對於薪酬委員會成員意見之處理：經出席之董事一致無異議依薪資報酬委員會之建議通過。

開會日期	項次	議案內容及後續處理
114年11月7日 第六屆第二次	一	請審議本公司 115 年薪酬預算。
	二	審議本公司具董事身份經理人及經理人 114 年特別激勵獎金，並提請董事會決議。
	薪酬委員會決議結果：委員會全體成員同意通過。	
	公司對於薪酬委員會成員意見之處理：經出席之董事一致無異議依薪資報酬委員會之建議通過。	

提名委員會：本公司並未設立提名委員會。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會督導情形？	V		<p>114年5月29日本公司「ESG指導委員會」由三名董事(含兩名獨立董事)組成，主席為董事長陳家湘先生。委員會職權包括(1)負責擬定公司 ESG 願景及策略 (2)監督 ESG 執行委員會執行狀況。</p> <p>114年8月7日召開 ESG 指導委員會，由 ESG 執行委員會主任委員報告治理面、環境面及社會面的執行成果，包含利害關係人關注議題、經營績效、研發投入、資訊安全、節能省水減廢減碳、社區關懷及職業安全衛生等。</p> <p>ESG 執行委員會每季定期召開會議，藉各部門代表於日常業務中與利害關係人持續溝通並收集反饋資訊，落實執行各項永續發展相關工作，並於會議中彙報與各部門間協調進度，以完成有關利害關係人關注之各項議題管控，促進經濟、環境與社會之間的平衡與確保企業永續發展策略充分落實於公司日常營運中。</p> <p>本公司訂有 ESG 政策，以管理公司對經濟、環境及社會風險與影響，以俾追求提升公司競爭力，改善員工生活品質與回饋社會的理念，實踐企業應負之社會責任，並將實踐成果與利害關係人關注議題每年定期至董事會報告，董事會檢視策略的進展，並於需要時敦促經營團隊進行調整。</p>	無重大差異

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			 <p style="text-align: center;">- ESG指導 / 執行委員會組織圖 -</p> <p>本公司ESG執行委員會於114年8月發行113年度永續報告書，請見網站：  <a href="https://www.xintec.com.tw/chi/Legal/ESG.html">https://www.xintec.com.tw/chi/Legal/ESG.html</a></p>	
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		<p>ESG 執行委員會依據永續報告書之重大性原則進行分析，與內外部利害關係人溝通，詳閱永續報告書第 1 章企業永續營運。</p> <p>本公司之風險管理委員會，於每季召開一次會議。相關風險管理策略請參見永續報告書第 3.4 風險管理及第 38-39 頁之附表。</p>	無重大差異

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p> <p>(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？</p>	V		<p>(一) 公司已建立健全環境管理程序及制度，並已於94年1月取得ISO14001環境管理系統驗證迄今。</p> <p>(二) 公司致力於提升資源使用及再利用之效能，已訂定相關資源使用管理程序及設置水資源回收再利用系統。114年共執行28項節水節電相關措施，均已完成，節省效益為新台幣18.45百萬元(節水4.45萬噸、節電3.31百萬度)。</p> <p>(三) 嚴格遵守法規，定期實施環保法令規定查核，掌握最新法規，依法實施環境檢測與污染防治對策，同時採用 ISO14001 環境管理系統策略，針對環境考量面進行評估並擬定預防措施，藉由定期內、外部稽核與第三方覆核檢視是否符合持續改善之目的，提升員工環境保護意識。</p> <p>依據環境部發布之氣候變遷及溫室氣體排放管理相關法令，執行年度盤查及查驗，以掌握更精確的溫室氣體排放現況，並有效地執行溫室氣體減量措施，期能落實環境正義並善盡地球公民之責，確保環境永續發展。</p> <p>公司以優化製程，逐年更換節能設備為目標，訂立廠區與辦公室各項節能規範，形成人員節能減碳意識，期望減少溫室氣體的排放總量。</p>	無重大差異

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展 實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		<p>(四) 公司於101年度完成GHG溫室氣體排放盤查、外部認證機構的查證通過，中壢廠及中壢二廠以104年為基準年；中壢三廠以109年為基準年。</p> <p>每年度持續執行溫室氣體排放量盤查與查證，公司全廠區 113 年及 114 年溫室氣體排放量分別為 104,059 及 129,775 ton-CO<sub>2</sub>e，其排放密集度分別為 14.74 及 17.93(ton-CO<sub>2</sub>e/百萬營收) (114 年溫室氣體排放量已經第三方查驗機構第一階段查證，尚未完成確信及取得查證聲明書)，並通過不斷提高資源循環利用，減少溫室氣體排放、廢棄物產生、廢水排放和化學品的使用，以提高製程的生態效益，預計在 119 年達到範疇一溫室氣體排放量較基準年減少 80%之目標。</p> <p>公司全廠區於 113 年及 114 年用水量(包含自來水、井水及回收水)分別為 1,739,242 公噸及 1,900,889 公噸，較前一年度增加 161,647 公噸用水，用水量增量 9.3%，主因為年營收增加 2.53%及新廠運轉測試。公司全廠區於 113 年及 114 年廢棄物分別為 1,056 公噸(有害廢棄物 404 公噸，非有害廢棄物 652 公噸)及 1,145 公噸(有害廢棄物 395 公噸，非有害廢棄物 750 公噸)，廢棄物密集度分別為 0.150 公噸/百萬營收及 0.158 公噸/百萬營收，較前一年度廢棄物密集度提高 5.3%，主因為新廠運轉測試，非有害廢棄物增加。</p> <p>我們以 ISO 14001 環境管理系統為基礎並採用了「P-D-C-A」的管理模式，以推動我們於污染防治上持續進步。104 年起推動每年達成節能 1%、廢棄物減量 2%及減少用水 3%之量化管理目標，均已達成。並將於 115 年配合政府法規要求，修正量化管理目標為節</p>	

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展 實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	V		<p>能1.5%、廢棄物減量1%及減少用水1%，直至合理可行水位。</p> <p>(一) 公司為樹立制度，健全組織，保障員工合法權益，特遵照勞動基準法、政府法令、『上市上櫃公司企業社會責任實務守則』及『責任商業聯盟及其行為準則』，訂定工作規則及招募聘僱政策，以作為全體同仁管理與遵守之依據，對求職者或受僱者之招募、甄試、進用、考核、升遷等，不因性別而有差別待遇(但工作性質僅適合特定性別者，不在此限)。本公司不得雇用童工從事工作，招募員工不得有歧視之行為，視實際業務需要而遴用，並以公開甄選方式力求機會均等，使人盡其才為選用原則。新進同仁需先經甄試或審核合格，再依公司新人進用規定，經簽呈核准後正式僱用之。本公司禁用被強迫、抵押、契約約束或非自願勞工，所有的工作必須自願的，並且員工基於適切告知擁有自由離職之權利。本公司承諾營造杜絕騷擾與虐待的工作環境。不得威脅或令其工作人員遭受嚴酷或非人道待遇。</p> <p>114年度RBA責任商業聯盟行為守則訓練(含誠信經營、法律和客戶要求、勞動人權、無不正當利益、公平交易、禁止內線交易等相關宣導)，計1,603人次，共1442.7人時。</p>	無重大差異
<p>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p>	V		<p>(二) 公司已訂定及實施合理員工福利措施，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬。依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，基層員工酬勞分派或調整薪資應不低於員工酬勞</p>	

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展 實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		<p>總額的百分之十，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依規定比例提撥員工酬勞。114年基層員工酬勞分派佔員工酬勞總額的24.1%。</p> <p>本公司員工之薪資報酬，乃依據個人工作績效表現、對公司的貢獻度、職務、職級等因素而訂，與經營績效成果之關聯性成正相關，主要包含基本薪資、津貼、獎金、員工酬勞及福利等。基本薪資主要以員工所擔任職位之同業市場水準及公司政策予以敘薪；津貼部分主要考量工作相關事項；獎金與員工酬勞則是連結員工工作績效、部門目標達成及公司經營成果計算發給；福利項目主要以符合法令規定為前提，並兼顧員工的需求。</p> <p>本公司女性員工超過50%。</p> <p>公司提供優於勞基法的特別休假制度，員工到職滿兩個月即可享有特別休假，方便員工於一年中排定假期。我們並依法給予各種假別，當同仁有請假需求時，能夠更無後顧之憂。此外，員工補助津貼包含婚喪喜慶補助、三節禮券、生日禮券及社團經費補助。</p> <p>(三) 公司重視員工職業安全與健康，依據職業安全衛生相關法規建置完善之安全衛生管理制度，致力提供安全、健康及友善之工作環境。公司定期辦理安全衛生教育訓練與健康促進宣導，內容涵蓋作業安全、防災應變、健康管理及職業病預防等，持續提升員工安全意識與自我健康管理能力。</p> <p>此外，公司依法設置駐廠醫師與專任護理師，推動健康檢查管理、職業病預防四大計畫及員工健康促進活動，並透過作業環境風險危害評估與改善措施，降低</p>	

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展 實務守則差異情形及原因								
	是	否	摘要說明									
<p>(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p> <p>(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？</p> <p>(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？</p>	V		<p>職業災害與健康風險，落實企業永續經營與員工照護責任。</p> <p>114年度廠內職業災害人次數為零。</p> <p>114年度火災之件數為零。</p> <p>(四) 為增進員工工作技能、讓員工快速融入工作環境、改善產品與服務品質、提升組織整體競爭力，本公司透過系統化的訓練藍圖展開教育訓練計畫，讓員工與公司一同成長。</p> <p>本公司年度訓練計畫包含主管及同仁訓練，114年共舉辦了36個班次的實體訓練課程。</p> <p>(五) 公司遵循品質系統要求，建有完善之缺陷防範機制及客訴反應系統，配合上下游整套供應鏈檢核機制為消費者層層把關且迅速回應。並秉持誠信正直的理念來對待客戶，以客戶為導向，提供客戶所需的技術、嚴謹的生產、優良的品質和優質的服務。</p> <p>(六) 公司在供應商企業社會責任行為準則中有相關規定。並於供應商責任條款中要求供應商之營運應透明、公開，注重股東權益，並努力達到企業的社會責任。</p>									
<p>五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？</p>	V		<p>本公司永續報告書公佈的所有資訊皆經由英國標準協會 (BSI) 外部查證依照 AA1000 AS V3 (2018) 中度保證等級的第 1 應用類型進行保證。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>發布單位</th> <th>依循項目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全球永續性報告協會 (GRI)</td> <td>GRI 準則(2021 年版)</td> </tr> <tr> <td>AccountAbility</td> <td>AA1000AP AccountAbility Principles : 2018</td> </tr> <tr> <td>聯合國</td> <td>永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs)</td> </tr> </tbody> </table>	發布單位	依循項目	全球永續性報告協會 (GRI)	GRI 準則(2021 年版)	AccountAbility	AA1000AP AccountAbility Principles : 2018	聯合國	永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs)	無重大差異
發布單位	依循項目											
全球永續性報告協會 (GRI)	GRI 準則(2021 年版)											
AccountAbility	AA1000AP AccountAbility Principles : 2018											
聯合國	永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs)											

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因								
	是	否	摘要說明									
			<table border="1"> <tr> <td>臺灣證券交易所</td> <td>臺灣證券交易所上市上櫃公司永續發展實務守則 上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法</td> </tr> <tr> <td>證券櫃檯買賣中心</td> <td>上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法</td> </tr> <tr> <td>金融穩定委員會 (FSB)</td> <td>氣候相關財務揭露建議 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures,TCFD)</td> </tr> <tr> <td>可持續發展會計準則委員會</td> <td>SASB 準則</td> </tr> </table>	臺灣證券交易所	臺灣證券交易所上市上櫃公司永續發展實務守則 上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法	證券櫃檯買賣中心	上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法	金融穩定委員會 (FSB)	氣候相關財務揭露建議 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures,TCFD)	可持續發展會計準則委員會	SASB 準則	
臺灣證券交易所	臺灣證券交易所上市上櫃公司永續發展實務守則 上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法											
證券櫃檯買賣中心	上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法											
金融穩定委員會 (FSB)	氣候相關財務揭露建議 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures,TCFD)											
可持續發展會計準則委員會	SASB 準則											
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定「永續發展實務守則」，運作情形皆依循永續發展實務守則辦理。												
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 其他本公司企業永續發展運作情形請參閱本公司網站永續發展專區。 <a href="https://www.xintec.com.tw/chi/Legal/ESG.html">https://www.xintec.com.tw/chi/Legal/ESG.html</a>												

#### 氣候相關資訊執行情形

##### 1、氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
<p>1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p> <p>2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。</p>	<p>1. 將氣候變遷議題納入公司全面風險管理範疇中，由董事會指派風險管理委員會，制定相關營運目標與計畫，定期執行檢討改善，並向董事會報告氣候變遷相關議題。</p> <p>2. 經由風險管理委員會為核心，由高階主管和各部門代表組成，根據氣候變遷相關財務揭露專案小組(TCFD)發佈的「氣候相關財務揭露建議書」指南，識別和盤點公司營運中潛在的氣候變遷風險、機會和財務影響，依據治理、政策、風險管理、指標和目標四個範疇下揭露相關資訊，並繪製風險機會重大議題矩陣圖，再根據矩陣分析結果，針對重大風險，提交董事會或高階管理階層，討論並制定風險管理策略，作為應對氣候變遷的行動措施。詳細內容請參閱本公司網站之永續報告書。</p>

項目	執行情形
<p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p> <p>4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</p> <p>5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p> <p>6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p> <p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p> <p>8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</p> <p>9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1及1-2)。</p>	<p>3.詳細內容請參閱本公司網站之永續報告書。</p> <p>4.各功能單位除依循董事會所通過的風險管理政策展開外，也結合廠區所建置之氣候行動機制(各項ISO管理系統)，依風險管理步驟整合至營運管理流程。詳細內容請參閱本公司網站之永續報告書。</p> <p>5.詳細內容請參閱本公司網站之永續報告書。</p> <p>6.詳細內容請參閱本公司網站之永續報告書。</p> <p>7.尚未使用內部碳定價作為規劃工具。</p> <p>8.詳細內容請參閱本公司網站之永續報告書。</p> <p>9. 請參閱下表1-1、1-2。</p>

### 1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

#### 1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO<sub>2</sub>e)、密集度(公噸 CO<sub>2</sub>e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

公司全廠區 113 年及 114 年溫室氣體排放量分別為 104,059 及 129,775tons-CO<sub>2</sub>e，其排放密集度分別為 14.74 及 17.93(ton-CO<sub>2</sub>e/百萬營收)，資料範圍涵蓋精材各廠區的直接排放量與能源間接排放量。

另公司有部分辦公室區域非屬工廠登記地址，其 113 年及 114 年溫室氣體排放量分別為 255 及 247 tons-CO<sub>2</sub>e。(114 年溫室氣體排放量已經第三方查驗機構第一階段查證，尚未完成確信及取得查證聲明書)。

#### 1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

113 年溫室氣體排放量由立恩威國際驗證股份有限公司進行查證並於 114 年 7 月 16 日核發查證聲明，其查證範圍包含精材科技中壢廠、

中壢二廠及中壢三廠，查證準則依據溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法(105.01.05)、溫室氣體排放量盤查作業指引(113)等法令規章，環境部發布之事業溫室氣體排放量資訊平台之相關最新規定，確信意見為依據查證者所執行之查證過程與程序，有充分證據顯示精材科技股份有限公司之溫室氣體主張不具實質差異，且係根據協議之查證準則規範的溫室氣體量化、監測與報告的標準予以準備，並公正地呈現溫室氣體數據及相關資訊。

114年溫室氣體排放量正由立恩威國際驗證股份有限公司進行查證，其查證範圍包含精材科技中壢廠、中壢二廠及中壢三廠，查證準則依據溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法(114.12.19)、溫室氣體排放量盤查作業指引(113)等法令規章，環境部發布之事業溫室氣體排放量資訊平台之相關最新規定。

## 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

公司於101年度係首次因法令規範執行盤查溫室氣體排放，中壢廠及中壢二廠以104年為基準年；中壢三廠以109年為基準年，精材已設定減碳目標，119年在溫室氣體類別1、2排放量減少15%以上、使用再生能源占比達公司總用電量7~15%，期望配合政府目標於139年完成淨零排放。

114年已執行策略及具體行動如下：

- 1.使用再生能源：精材於114年採購太陽能再生能源憑證，年近採購3百萬度再生能源，可減少約1,416 tons-CO<sub>2</sub>e 碳排放量
- 2.提升能源使用效率：精材每年皆執行各項節能專案，例如汰換高效率照明燈具、汰換節能空調設備及空調溫度調整等節能措施，且部分廠區已通過ISO 50001 能源管理驗證，逐步降低廠區能耗，114年推動節能成效共降低3.31百萬度，可減少約1,570 tons-CO<sub>2</sub>e 碳排放量。

## 風險管理策略

面向	風險項目	說明	因應策略
財務風險	匯率變動	本公司營收主要係以美元計價，部分製造成本亦以外幣支付，因此，任何顯著的國際匯率變動均可能對公司損益造成不利之影響。	本公司主要以進貨所產生之應付帳款(外幣負債)與收入所產生之應收帳款(外幣資產)相互沖抵，發揮自然避險之效果，以降低匯率變動風險。同時密切注意匯率趨勢，定期檢視非功能性貨幣計價之資產及負債之部位變化，使用遠期外匯合約等衍生金融工具或買賣即期外匯管理匯率風險，以降低匯率波動對損益的影響。
	利率變動	利率的變動對公司損益影響可分為兩部分，營業外收入部分，約當現金利息收入隨利率上升而增加，利息費用則將因利率上升而增加。	為避免未來利率走高，增加融資成本之不確定性，本公司持續關注利率走勢，未來將視市場狀況及中長期負債部位，決定是否向銀行簽定利率交換交易，以部份規避利率波動之風險，降低升息之不利影響。
	技術開發	半導體業技術發展速度快，客戶需求快速變動，同業間競爭激烈，對於先進製程之需求不斷提高。	1.配合市場以及客戶感應器(Sensor)的新產品技術需求，持續開發晶圓級新的製程技術並購入相關設備，應用於多樣生物辨識感測器、影像感測器、環境光源感測器、微機電(MEMS)、功率場效電晶體等產品，提供包括晶圓級封裝以及中後端晶圓級製程的技術服務。

面向	風險項目	說明	因應策略
			<p>2.針對 System in package，投入開發 Liquid Molding、through molding via 相關製程以提供多樣性封裝選擇。</p> <p>3.聆聽客戶感應器(Sensor)應用需求，搭配核心技術提高產品附加價值。</p>
	供應商管理	原物料供應商及生產設備有單一供應商之情形，可能造成營運生產之斷料或不穩定之風險。	透過新供應商開發及現有供應商生產及品質系統的稽核，減少單一供應商比例，同時降低現有供應商缺料及品質不穩定風險。
營運風險	業務風險	客戶過於集中。	積極開發多元化的產品與客戶群，以分散業務集中風險。
	法律風險	遵循所有適用的法規。 法令法規修正。	各部門須就其業務範圍內適用之法規進行監控，法務部門亦會不定期至相關網站下載適用法規之最新法律規定，並轉寄給有關單位以利各單位進行風險辨識、評估，訂定策略並為風險處理。
環境風險	氣候變遷	氣候變遷所導致之影響不容小覷，全球隨著溫室氣體排放量日趨益增，溫室效應明顯加劇導致全球暖化，使全球地表平均溫度升高、海洋酸化、冰層消融、海平面上升等顯著環境變遷，影響範圍涵蓋海洋與陸地，全球暖化所引發極端氣候近年來更是頻繁易見，首當其衝者為周遭環境生態遭受破壞，進而甚至可能波及社會經濟活動與人類安全。	<p>1.嚴格遵守法規，定期實施環保法令規定查核，掌握最新法規，依法實施環境檢測與污染防治對策，同時採用 ISO14001 環境管理系統策略，針對環境考量面進行評估並擬定預防措施，藉由定期內、外部稽核與第三方覆核檢視是否符合持續改善之目的，提升員工環境保護意識。</p> <p>2.依據環境部發布之氣候變遷及溫室氣體排放管理相關法令，執行年度盤查及查驗，以掌握更精確的溫室氣體排放現況，並有效地執行溫室氣體減量措施，期能落實環境正義並善盡地球公民之責，確保環境永續發展。</p> <p>3.評估氣候變遷對公司可能帶來之機會與風險，於營運策略規劃和決策過程中納入氣候變遷因子；積極推動綠色製程及各項環保節能減碳措施，評估綠電購買，提升尾氣削減設備安裝率，逐年更換節能設備，並訂立廠區各項節能規範，形成人員節能減碳意識，期望減少溫室氣體的排放總量，以減緩與調適氣候變遷所帶來之營運衝擊。</p>
	水資源	極端型氣候造成水資源匱乏	<p>1.透過回收設備建立與改善，增加水回收次數並減少自來水用量。</p> <p>2.改善製程用水量，降低生產時對於水的使用量。</p>
社會風險	員工招募	受限臺灣人口少子化衝擊與半導體產業人力市場需求大於供給，造成人才招募不易。	依據公司營運計畫定期檢視人力需求，結合公立就業服務機關與其他招募管道適時招募合適之人才，並且在符合政府法規按比例聘僱外籍人員，加速補足所需之人力缺口。
	勞動安全	精材公司重視職業安全，認為做好安全與衛生管理是照顧員工及其家庭應有的作為，也是對社區與社會承諾的直接回饋。 公司制定環安衛政策，以風險管理精神為基礎，持續進行改善，杜絕可預見的危險與損失控制，以保障員工安全與健康，並建構良好安全衛生工作環境。	精材所有廠區均取得職業安全衛生管理系統 (ISO 45001) 及臺灣職業安全衛生管理系統 (TOSHMS) 驗證通過。透過持續改善安全衛生管理系統，達成預防意外事故、促進員工安全、衛生及保護公司資產的目標。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評 估 項 目	運 作 情 形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>		<p>(一) 本公司訂有「誠信經營守則」，並在「工作規則」明定所有員工均應清楚了解且遵守從業道德規範及個人誠信，並秉持誠實、嚴謹及敬業之精神執行職務。</p> <p>(二) 本公司「工作規則」規定不得要求、接受或給予任何可能損及忠於職守或專業判斷之餽贈、招待或任何形式的賄賂。</p> <p>(三) 誠信正直係本公司企業文化中最重要核心價值，會於新進員工教育訓練及全體在職員工訓練中宣導，並建立完善的違規懲戒及申訴制度。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專職單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>		<p>(一) 本公司與他人簽訂契約時，均儘可能充分了解對方誠信經營情形，並宜將誠信經營納入商業契約中。</p> <p>(二) 本公司為健全與落實誠信經營之管理，由人力資源處負責誠信經營政策與行為指南之制定及監督執行，且每年一次向董事會報告。114年推動誠信經營與執行狀況於114年11月7日向董事會報告，114年並未發現員工或管理階層有違反誠信經營事項。</p> <p>(三) 本公司已於「工作規則」明訂應迴避任何可能造成個人利益與公司利益之間的衝突，並完成年度迴避利益衝突申報。董事會各項議案，有利益衝突時，皆依迴避原則，不參與討論，並離席不參與表決。</p> <p>(四) 本公司透過建立會計制度及內部控制制度之規範，落實誠信經營理念。內部稽核亦依法令遵循及風險評估訂定年度稽核計畫，並據以查核以確保各項控制作業之正確性、健全性及有效性，結果並無發現舞弊、不法或違背受託義務等不誠信行為。</p> <p>(五) 公司每年均定期舉辦誠信經營之教育訓練，以落實誠信價值，並將重點宣導事項製作宣導DM，宣導於同仁執行業務時應注意。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p> <p>(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>	√		<p>本公司已於「工作規則」明訂懲戒制度，並於公司網站中載明若有任何人發現本公司員工或利害關係人進行任何疑似或可能違反本公司從業道德之行為時，請務必通知本公司；且此舉報行為，將交由董事長或其指定之高階主管直接進行調查、處理及預防再發之對策，對於檢舉人均予以保密，免於遭受不當之處置。</p>	無重大差異
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？</p>	√		<p>(一) 已於本公司架設之網站中，揭露公司之經營理念係以誠信/創新/客戶導向為宗旨，並於年報及公開說明書中揭露誠信經營情形。</p>	無重大差異
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定誠信經營守則，與上市上櫃公司誠信經營守則並無差異。</p>				
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：無。</p>				

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：無。

(八) 內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書：

114 年度內部控制制度聲明書索引如下（上櫃公司股票代號 3374）：

MOPS 公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>) > 單一公司 > 公司治理 > 公司規章/內部控制 > 內控聲明書公告

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

本公司股東會於 114 年度至年報刊印日止共召集一次常會，重要決議及執行情形如下：

1. 盈餘分配或盈虧撥補：核准 113 年度盈餘分派案。

執行情形：決議通過。本公司 113 年度稅後淨利為新台幣 1,669,720 仟元，加列確定福利計劃之再衡量數新台幣 9,887 仟元後，112 年度可分配盈餘為新台幣 1,679,607 仟元，經提撥法定盈餘公積新台幣 167,961 仟元後，加計以前年度未分配保留盈餘新台幣 3,586,284 仟元後，期末未分配盈餘為新台幣 5,097,930 仟元。考量 113 年獲利、資本預算、中期營運規劃及財務狀況後，擬自 113 年度可分配盈餘中提撥新台幣 678,411 仟元，每股分派現金股利新台幣 2.5 元。其配息基準日訂定為 114 年 6 月 30 日。

2. 章程修訂：通過修訂公司章程。

執行情形：決議通過。於 114 年 7 月 15 日經主管機關准予登記。

3. 營業報告書及財務報表：承認 113 年度營業報告書及財務報表。

執行情形：承認 113 年度營業報告書及財務報表，其中全年營收為新台幣 7,059,941 仟元，稅後淨利為新台幣 1,669,720 仟元，每股淨利為新台幣 6.15 元。

4. 董監事選舉：全面改選董事六名(含獨立董事四名)。

執行情形：當選名單如下：陳家湘(台灣積體電路製造股份有限公司代表人)、游秋山(台灣積體電路製造股份有限公司代表人)、王文宇(獨立董事)、謝徽榮(獨立董事)、梁明成(獨立董事)、李雨師(獨立董事)。

5. 其他事項：核准解除新任董事及其代表人之競業禁止限制

執行情形：決議通過，並已依股東會決議執行完成。

本公司於 114 年度至年報刊印日止共召開七次董事會，重要決議摘要有：

核准 113 年度之營業報告書及財務報表、核准本公司 113 年度員工現金酬勞及董事酬勞與報酬、核准本公司 113 年度盈餘分派案、核准本公司修訂「公司章程」、核准本公司應選董事 6 人(含獨立董事 4 人)，並於 114 年股東常會辦理改選、核准召集本公司 114 年股東常會、核准資本支出預算、核准本公司與台積公司簽訂契約、核准本公司 114 年度財務計畫、核准 114 年度本公司向關係人台積公司進行銷貨、勞務或技術服務交易，金額不超過美元 2 億元、核准本公司訂定基層員工薪資水準及調整整體薪酬制度、核准本公司 113 年度董事報酬及酬勞及 114 年度董事報酬及酬勞政策、核准本公司具董事身份之經理人及經理人之 113 年第二次特別激勵獎金、核准本公司具董事身份之經理人及經理人 113 年度之績效評估及 114 年度薪資調整、核准本公司具董事身份之經理人及經理人 113 年度之員工酬勞、核准本公司具董事身份之經理人及經理人 113 年度薪資報酬及 114 年度薪資報酬政策、因配合會計師事務所內部輪調需要，本公司參考審計品質指標(AQIs)對簽證會計師進行評估，經評估後，勤業眾信聯合會計師事

務所蔡美貞與林心彤會計師均符合獨立性及適任性要求，並核准其擔任簽證會計師、核准本公司113年度之「內部控制制度聲明書」、核准法人股東台積公司所指派之代表人陳家湘先生及游秋山先生為本公司第十一屆董事被提名人，以及李雨師女士、王文宇先生、謝徽榮先生及梁明成先生為獨立董事被提名人、核准解除新任董事及其代表人之競業禁止限制，並提請股東會通過、核准本公司114年度第1季財務報表、核准維持本公司董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構、核准維持本公司具董事身分之經理人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構、核准取得銀行額度、推舉陳家湘先生續任董事長、核准任命梁明成先生、王文宇先生及謝徽榮先生為本公司第6屆薪資報酬委員會之委員、核准任命陳家湘先生、梁明成先生及李雨師女士為本公司第2屆ESG指導委員會之委員、核准本公司114年度第2季財務報表、核准本公司2024年度永續報告書、核准本公司修訂「公司治理實務守則」、核准114年度委任勤業眾信聯合會計師事務所簽證服務公費由新台幣2,970,000元調整為新台幣3,150,000元、核准本公司114年度第3季財務報表、配合會計師事務所內部輪調需要，本公司參考審計品質指標(AQIs)對簽證會計師進行評估，經評估後，勤業眾信聯合會計師事務所陳彥君與林心彤會計師均符合獨立性及適任性要求、核准115年度委任勤業眾信聯合會計師事務所簽證服務公費為新台幣3,270,000元、核准本公司具董事身份之經理人及經理人114年特別激勵獎金、核准修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」、核准本公司115年度稽核計畫、核准114年度營業報告書、核准本公司114年度員工現金酬勞及董事酬勞與報酬、核准本公司114年度盈餘分派案、核准召集本公司115年股東常會、核准本公司115年度財務計畫、核准115年度本公司向關係人台積公司進銷貨、進行勞務或技術服務交易，預計金額不超過美金3億元整、核准本公司114年度董事報酬及酬勞及115年度董事報酬及酬勞政策、核准本公司具董事身份之經理人及經理人之114年第二次特別激勵獎金、核准本公司具董事身份之經理人及經理人114年度之績效評估及115年度薪資調整、核准本公司具董事身份之經理人及經理人114年度之員工酬勞、核准本公司具董事身份之經理人及經理人114年度薪資報酬及115年度薪資報酬政策、核准本公司114年度之「內部控制制度聲明書」。

- (十) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四、簽證會計師公費資訊：

- (一) 給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容：

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名		會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	陳彥君	林心彤	114 年度	2,430	720	3,150	

註：本年度非審計公費為稅務簽證620仟元、覆核年報80仟元及出具非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查表20仟元。

- (二) 更換會計師事務所且更換年度給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無。
- (三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無。

五、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師

更換日期	不適用		
更換原因及說明	不適用		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		會計師
	情況		委任人
	主動終止委任		不適用
不再接受(繼續)委任			
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	不適用		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無	√	
說明	無		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二) 關於繼任會計師

事務所名稱	不適用
會計師姓名	不適用
委任之日期	不適用
就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

(三) 前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	114 年 度		115 年度截至3月30日止	
		持 有 股 數 增 ( 減 ) 數	質 押 股 數 增 ( 減 ) 數	持 有 股 數 增 ( 減 ) 數	質 押 股 數 增 ( 減 ) 數
董 事	台灣積體電路製造股份有限公司	0	0	0	0
	代表人-陳家湘	0	0	0	0
	代表人-游秋山	0	0	0	0
獨立董事	王文宇	0	0	0	0
獨立董事	謝徽榮	0	0	0	0
獨立董事	溫環岸(註1)	0	0	不適用	不適用
獨立董事	梁明成	0	0	0	0
獨立董事	李雨師(註1)	0	0	0	0
總 經 理	陳家湘	0	0	0	0
副總經理	林恕敏	0	0	0	0
協 理	范振梅	0	0	0	0
協 理	劉滄宇	0	0	0	0
協 理	藍和谷	0	0	0	0
協 理	馬中文	0	0	0	0
處 長 暨 公 司 治 理 主 管	周正德	0	0	0	0
大 股 東	台灣積體電路製造股份有限公司	0	0	0	0

註 1：李雨師董事於 114 年 5 月 29 日股東會選任為獨立董事，溫環岸董事任期至該次股東常會(114 年 5 月 29 日)完成時止，附表為溫環岸董事辭任前、李雨師董事選任後之持股變動數。

(二) 股權移轉之相對人為關係人者：無。

(三) 股權質押之相對人為關係人者：無。

八、持股比例占前十名股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

115年3月30日；單位：千股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	名稱	關係	
台灣積體電路製造股份有限公司 代表人：魏哲家	111,282	41.01	0	0	0	0	無	無	
花旗(台灣)商業銀行受託保管BNP金融市場投資專戶	3,935	1.45	0	0	0	0	無	無	
洪慶鐘	2,948	1.09	0	0	0	0	無	無	
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶	2,518	0.93	0	0	0	0	無	無	
花旗(台灣)商業銀行受託保管iShares核心MSCI新興市場ETF投資專戶	1,844	0.68	0	0	0	0	無	無	
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金	1,758	0.65	0	0	0	0	無	無	
何宗翰	1,700	0.63	0	0	0	0	無	無	
華南商業銀行股份有限公司受託保管群益馬拉松證券投資信託基金專戶	1,602	0.59	0	0	0	0	無	無	
花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶	1,595	0.59	0	0	0	0	無	無	
渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資	1,571	0.58	0	0	0	0	無	無	

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：不適用。

## 參、募資情形

### 一、股本來源

單位：新台幣仟元；千股 115年3月30日

年/月	發行價格 新台幣 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之 財產抵充股款 者(仟元)	其他
87/9	10	64,000	640,000	28,000	280,000	創立 216,000	技術股 64,000	87/9/11 經(○八七)商字第 087127301 號核准在案
88/7	10	64,000	640,000	43,250	432,500	現增 152,500	無	88/7/26 經(○八八)商字第 088127212 號核准在案
89/9	10	64,000	640,000	55,000	550,000	現增 117,500	無	89/9/20 經(○八九)商字第 089134667 號核准在案
91/8	12	64,000	640,000	64,000	640,000	現增 90,000	無	91/8/19 經授商字第 09101336780 號核准在案
92/3	12	88,000	880,000	73,000	730,000	現增 90,000	無	92/3/19 經授商字第 09201078970 號核准在案
92/4	11	88,000	880,000	83,000	830,000	現增 100,000	無	92/4/30 經授商字第 09201130010 號核准在案
92/9	15	120,000	1,200,000	103,000	1,030,000	現增 200,000	無	92/9/1 經授商字第 09201260090 號核准在案
92/12	20	120,000	1,200,000	115,000	1,150,000	現增 120,000	無	92/12/4 經授商字第 09201327560 號核准在案
95/4	10	120,000	1,200,000	120,000	1,200,000	現增 50,000	無	95/4/10 經授商字第 09501063960 號核准在案
95/7	-	180,000	1,800,000	120,000	1,200,000	核定股本變更	無	95/7/4 經授商字第 09501131570 號核准在案
96/2	15	260,000	2,600,000	210,526	2,105,260	私募現增 905,260	無	96/2/16 經授商字第 09601036790 號核准在案
96/8	-	260,000	2,600,000	215,739	2,157,391	盈餘轉增資： 27,368 員工紅利轉增資： 24,763	無	96/8/6 經授商字第 09601184170 號核准在案
97/7	-	260,000	2,600,000	221,279	2,212,794	盈餘轉增資： 21,574 員工紅利轉增資： 33,829	無	97/7/24 經授商字第 09701180530 號核准在案
97/11	-	260,000	2,600,000	221,909	2,219,091	行使員工認股權 憑證 6,297	無	97/11/27 經授商字第 09701302390 號核准在案
98/3	-	260,000	2,600,000	222,225	2,222,251	行使員工認股權 憑證 3,160	無	98/3/30 經授商字第 09801056560 號核准在案
98/6	-	260,000	2,600,000	222,660	2,226,601	行使員工認股權 憑證 4,350	無	98/6/26 經授商字第 09801127190 號核准在案
98/7	-	260,000	2,600,000	224,629	2,246,289	盈餘轉增資：11,111 員工紅利轉增資： 8,577	無	98/7/22 經授商字第 09801153270 號核准在案
98/9	-	260,000	2,600,000	225,533	2,255,327	行使員工認股權 憑證 9,038	無	98/9/9 經授商字第 09801206430 號核准在案
98/12	-	260,000	2,600,000	225,766	2,257,657	行使員工認股權 憑證 2,330	無	98/12/18 經授商字第 09801290970 號核准在案
99/4	-	260,000	2,600,000	226,529	2,265,287	行使員工認股權 憑證 7,630	無	99/4/8 經授商字第 09901068120 號核准在案

年/月	發行價格 新台幣 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之 財產抵充股款 者(仟元)	其他
99/7	-	260,000	2,600,000	227,275	2,272,746	行使員工認股權 憑證 7,459	無	99/7/16 經授商字第 09901144980 號核准在案
99/9	-	260,000	2,600,000	227,367	2,273,666	行使員工認股權 憑證 920	無	99/9/2 經授商字第 09901200650 號核准在案
99/12	-	260,000	2,600,000	227,968	2,279,684	行使員工認股權 憑證 6,018	無	99/12/6 經授商字第 09901271820 號核准在案
100/4	-	260,000	2,600,000	228,561	2,285,607	行使員工認股權 憑證 5,923	無	100/4/11 經授商字第 10001069460 號核准在案
100/7	-	260,000	2,600,000	229,026	2,290,265	行使員工認股權 憑證 4,658	無	100/7/1 經授商字第 10001142280 號核准在案
100/8	-	260,000	2,600,000	233,256	2,332,557	盈餘轉增資: 22,883 員工紅利轉增資: 19,410	無	100/8/10 經授商字第 10001184920 號核准在案
100/9	-	260,000	2,600,000	233,396	2,333,962	行使員工認股權 憑證 1,405	無	100/9/6 經授商字第 10001207740 號核准在案
100/12	-	260,000	2,600,000	233,579	2,335,794	行使員工認股權 憑證 1,831	無	100/12/2 經授商字第 10001274670 號核准在案
101/4	-	260,000	2,600,000	233,581	2,335,811	行使員工認股權 憑證 17	無	101/4/2 經授商字第 10101055600 號核准在案
101/6	-	260,000	2,600,000	233,785	2,337,846	行使員工認股權 憑證 2,035	無	101/6/27 經授商字第 10101120250 號核准在案
101/7	-	260,000	2,600,000	236,121	2,361,209	盈餘轉增資: 23,363	無	101/7/30 經授商字第 10101155880 號核准在案
101/9	-	260,000	2,600,000	236,153	2,361,526	行使員工認股權 憑證 317	無	101/9/13 經授商字第 10101188740 號核准在案
101/12	-	260,000	2,600,000	236,205	2,362,046	行使員工認股權 憑證 520	無	101/12/12 經授商字第 10101253820 號核准在案
102/4	-	260,000	2,600,000	236,208	2,362,079	行使員工認股權 憑證 33	無	102/04/01 經授商字第 10201058510 號核准在案
102/8	-	260,000	2,600,000	236,267	2,362,667	行使員工認股權 憑證 588	無	102/08/06 經授商字第 10201152570 號核准在案
102/8	-	260,000	2,600,000	236,290	2,362,896	行使員工認股權 憑證 229	無	102/08/30 經授商字第 10201179150 號核准在案
102/12	-	260,000	2,600,000	236,371	2,363,714	行使員工認股權 憑證 818	無	102/12/11 經授商字第 10201249330 號核准在案
103/3	-	260,000	2,600,000	236,402	2,364,019	行使員工認股權 憑證 305	無	103/03/28 經授商字第 10301053810 號核准在案
103/7	-	260,000	2,600,000	236,474	2,364,739	行使員工認股權憑 證 720	無	103/7/8 經授商字第 10301136750 號核准在案
103/9	-	260,000	2,600,000	236,481	2,364,814	行使員工認股權憑 證 75	無	103/9/4 經授商字第 10301184300 號核准在案
103/12	-	260,000	2,600,000	238,051	2,380,508	行使員工認股權憑 證 15,694	無	103/12/5 經授商字第 10301253830 號核准在案
104/3	-	260,000	2,600,000	238,121	2,381,207	行使員工認股權憑 證 699	無	104/3/6 經授商字第 10401033070 號核准在案
104/4	42	300,000	3,000,000	268,121	2,681,207	現增 300,000	無	104/4/15 經授商字第 10401064200 號核准在案
104/6	-	300,000	3,000,000	268,427	2,684,265	行使員工認股權憑 證 3,059	無	104/6/8 經授商字第 10401105400 號核准在案

年/月	發行價格 新台幣 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之 財產抵充股款 者(仟元)	其他
104/12	-	300,000	3,000,000	268,768	2,687,680	行使員工認股權憑證 3,414	無	104/12/2 經授商字第 10401254910 號核准在案
105/3	-	300,000	3,000,000	268,876	2,688,761	行使員工認股權憑證 1,082	無	105/3/3 經授商字第 10501040250 號核准在案
105/5	-	300,000	3,000,000	269,195	2,691,948	行使員工認股權憑證 3,187	無	105/5/31 經授商字第 10501108730 號核准在案
105/11	-	300,000	3,000,000	269,590	2,695,901	行使員工認股權憑證 3,953	無	105/11/30 經授商字第 10501277360 號核准在案
106/3	-	300,000	3,000,000	269,853	2,698,534	行使員工認股權憑證 2,633	無	106/3/16 經授商字第 10601032450 號核准在案
106/3	-	300,000	3,000,000	271,353	2,713,534	發行限制員工權利新股 15,000	無	106/3/30 經授商字第 10601037310 號核准在案
106/6	-	300,000	3,000,000	272,149	2,721,493	行使員工認股權憑證 7,959	無	106/6/2 經授商字第 10601069300 號函
106/8	-	300,000	3,000,000	272,109	2,721,093	行使員工認股權憑證 1,480, 註銷限制員工權利新股 1,880	無	106/8/17 經授商字第 10601111270 號函
106/11	-	300,000	3,000,000	271,919	2,719,193	註銷限制員工權利新股 1,900	無	106/11/28 經授商字第 10601158830 號函
107/2	-	300,000	3,000,000	271,695	2,716,949	註銷限制員工權利新股 2,244	無	107/2/22 經授商字第 10701019760 號函
107/8	20	300,000	3,000,000	271,795	2,717,949	發行限制員工權利新股 1,000	無	107/8/22 經授商字第 10701106860 號
108/3	20	300,000	3,000,000	271,744	2,717,441	發行限制員工權利新股 2,000, 註銷限制員工權利新股 2,508	無	108/3/15 經授商字第 10801026540 號函
108/6	-	400,000	4,000,000	271,744	2,717,441	變更額定股本	無	108/6/18 經授商字第 10801072960 號函
108/8	-	400,000	4,000,000	271,723	2,717,225	註銷限制員工權利新股 216	無	108/8/26 經授商字第 10801115200 號函
109/3	-	400,000	4,000,000	271,364	2,713,643	註銷限制員工權利新股 3,582	無	109/3/12 經授商字第 10901031500 號函

單位：股 115年3月30日

股份 種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	271,364,316	128,635,684	400,000,000	

## 二、主要股東名單

(股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比率佔前十名之股東名稱、持有股數及比例)

單位：股 115年3月30日

主要股東名稱	持有股數	持股比例
台灣積體電路製造股份有限公司 代表人：魏哲家	111,281,925	41.01
花旗(台灣)商業銀行受託保管BNP金融市場投資專戶	3,935,000	1.45
洪慶鐘	2,948,000	1.09
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶	2,517,529	0.93
花旗(台灣)商業銀行受託保管iShares核心MSCI新興市場ETF投資專戶	1,844,000	0.68
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金	1,757,714	0.65
何宗翰	1,700,000	0.63
華南商業銀行股份有限公司受託保管群益馬拉松證券投資信託基金專戶	1,602,000	0.59
花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶	1,595,266	0.59
渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資	1,571,225	0.58

## 三、公司股利政策及執行狀況

### (一) 股利政策說明：

公司股利政策係依據本公司營運狀況、資金需求、資本支出預算、內外部整體環境變化並兼顧股東利益，由董事會予以訂定，在無其它特殊情況考量下，以當年度稅後盈餘 35%~85% 為分派原則。

本公司章程第廿七條內容如下：

本公司年度決算如有盈餘，應先依法完納稅捐，彌補累積虧損後，次提撥百分之十為法定盈餘公積，如法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，得不提列，其餘再依法令或主管機關規定應提列及迴轉特別盈餘公積後；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分派議案，提請股東會決議分派之。

本公司章程第廿七條之一內容如下：

本公司股利發放政策係依據公司資本預算、中長期營運規劃及財務狀況，依下列原則經股東會決議後分派之：

1. 公司得依財務、業務及經營面等因素之考量將當年度可分配盈餘全數分派。盈餘之分派得以股票股利或現金股利之方式為之，但因本公司目前正處於營運成長期，未來將視擴充計劃及投資資金之需求，於分派當年度可分配盈餘時，現金股利分派之比例以不低於股利總額之百分之五十。
2. 於當年度公司無盈餘可分派，或雖有盈餘但盈餘數額遠低於公司前一年度實

際分派之盈餘，或依公司財務、業務及經營面等因素之考量，得將公積全部或一部依法令或主管機關規定分派。

(二) 本次股東會擬議股利分配之情形：

盈餘分配議案業經 115 年 2 月 5 日董事會決議分派現金股利 678,410,790 元(每股 2.5 元)。

四、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

五、員工、董事及監察人酬勞：

(一) 本公司章程第廿七條內容如下：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞，且董事酬勞給付之對象不包括擔任本公司經理人之董事，員工酬勞及董事酬勞應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。基層員工酬勞分派或調整薪資應不低於員工酬勞總額的百分之十。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依規定比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

(二) 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司 114 年度估列員工酬勞 203,623 仟元、董事酬勞 2,016 仟元及董事報酬 4,032 仟元，係依稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之利益為基礎按一定比率估列。若上述估列金額與實際發放金額有差異時，則依會計估計變動處理，並於發放年度調整入帳。

(三) 董事會通過分派酬勞情形：

1. 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

115 年 2 月 5 日董事會決議通過員工酬勞 203,623 仟元、董事酬勞 2,016 仟元及董事報酬 4,032 仟元，與認列費用年度估列金額並無差異。

2. 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：

本期無擬議配發員工股票酬勞之情事，故不適用。

(四) 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際配發情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司 113 年度配發員工酬勞 267,994 仟元及董事酬勞 2,016 仟元，實際配發情形與估列之費用並無差異。

六、公司買回本公司股份情形：無。

七、公司債、特別股、海外存託憑證及併購或受讓他公司股份發行新股情形：無。

八、員工認股權憑證辦理情形：無。

九、限制員工權利新股：無。

十、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

十一、資金運用計畫執行情形：無。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一) 業務範圍

##### 1. 所營業務之主要內容及其營業比重：

單位：新台幣仟元

項 目	114 年度營業額	營 業 比 重 (%)
測試服務	3,464,648	47.86
晶圓級尺寸封裝	3,256,206	44.98
晶圓級後護層封裝	374,660	5.18
其 他	143,031	1.98
合 計	7,238,545	100.00

##### 2. 公司目前之服務項目：

###### (1) 目前服務項目：

###### a. 晶圓級尺寸封裝 (Wafer Level Chip Scale Packaging)

- 影像感應器 (Image Sensor)
- 光學感應器 (Optical Sensor)
- 慣性感測器 (IMU)
- 新型生物辨識器 (Biometric Sensor)

###### b. 晶圓級後護層封裝 (Wafer Level Post Passivation Interconnection)

- 影像感應器 (Image Sensor)
- 慣性感測器 (IMU)
- 微機電揚聲器 (MEMS Speaker)
- 矽基板氮化鎵 (GaN-on-Si) 應用

###### c. 測試服務 (Testing Services)

- 晶圓測試 (300mm Wafer CP Testing)
- 最終測試 (FT, Final Testing)

###### (2) 計劃開發之新服務：

本著晶圓級封裝測試技術及資源，持續提供技術服務應用於各類輕薄短小之新消費性電子如手機、筆記型電腦、個人行動電子裝置、穿戴式裝置、先進駕駛輔助系統、汽車環景安全、倒車影像、安全監測裝置、醫療、健康科技及光學影

像感測器、AR/VR 裝置等，及微機電系統、射頻元件、功率元件與新型生物辨識器的封裝服務。

## (二) 總體經濟環境

2025 年台灣全年實質 GDP 成長率高達 7.37%-8.68%(各機構預估區間)。遠超年初預測。這波增長主因全球對 AI 伺服器與半導體的爆發性需求，帶動台灣出口與民間投資大幅衝高。2025 年第四季單季成長率更一度突破 12%，使台灣奪下該年度亞洲主要經濟體成長冠軍。

而景氣加溫的效果，也反映在整體經濟數據上，主計總處最新公布去年第四季的經濟成長率預測，從 11 月的預測數 7.91%，大幅上修 4.77 個百分點，來到 12.68%。中央大學經濟系教授 徐之強：「可能是大概 20 年來年增率最好的一季，從這邊就知道，台灣的經濟景氣在去年表現得非常亮眼，當然最主要的部份，還是 AI 相關的投資，以及出口帶動台灣整體的經濟成長率。」

主計總處日前公布 2025 年 GDP 概估統計，全年台灣經濟成長率上修至為 8.63%；而 2025 年第四季經濟成長率概估則為 12.68%，雙雙寫下新高。主計總處指出，主要受惠於商品出口表現強勁，加上民間消費力道回溫。在 AI 投資與出口動能持續支撐下，專家認為，2026 年台灣經濟成長仍具向上空間。

## (三) 產業概況

### 1. 全球封測與半導體相關市場概況說明

相對於 2024 年，2025 年消費性電子產品需求僅溫和，但 2025 年美國政策不確定性推動電子與半導體供應鏈啟動預防性備貨，加上旗艦手機應用處理器、AI 晶片需求暢旺，提供台灣晶圓代工業營收成長動能。受惠 AI 應用基礎設施建設百花齊放，世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 上修 2025 年全球半導體產值預估至 7,720 億美元，創新高，年增 22%，最新產值預估比原預期調升 7%，看好 2026 年整體產值將再成長 25% 以上，達 9,750 億美元，逼近 1 兆美元大關。台灣居全球半導體供應鏈的關鍵地位，而 AI 應用需求攀升，半導體產業投資亦隨之成長。

WSTS 預估，2025 年全球邏輯 IC 營收增長 37.1%，是增幅最大的產品類別，其後依序為記憶體營收成長 27.8%，感測器營收成長 10.4%、微處理器營收成長 7.9%、類比 IC 營收成長 7.5%、光電子元件營收成長 3.7%；受汽車領域需求疲軟影響，分離式元件營收恐下滑 0.4%。區域市場方面，該機構分析，美洲和亞太地區預計年增幅將擴大到 25% 至 30%，反映邏輯和記憶力的實力；歐洲估年增 6%，日本則恐下降 4%。

根據工研院產科國際所(IEK)預估，2025 年台灣半導體產業在 AI 強勁需求推動下持續創高，預估總產值將突破新台幣 6.5 兆元，較 2024 年成長 22.2%。其中 IC 設計業產值為新台幣 14,265 億元(USD\$ 44.4B)，較 2024 年成長 12.1%；IC 製造業為新

台幣 43,602 億元(USD\$135.8B)，較 2024 年成長 27.5%，其中晶圓代工為新台幣 41,622 億元(USD\$129.7B)，較 2024 年成長 28.3%，記憶體與其他製造為新台幣 1,980 億元(USD\$6.2B)，較 2024 年成長 12.7%；IC 封裝業為新台幣 4,803 億元(USD\$15.0B)，較 2024 年成長 13.5%；IC 測試業為新台幣 2,305 億元(USD\$7.2B)，較 2024 年成長 15.2%。

台灣蟬聯全球晶圓代工與封測第一，其中晶圓代工產值突破 4.3 兆元、封測產值約 7,100 億元。基於影像感測器和 MEMS 的智慧感測器的技術創新，從智慧手機、穿戴式裝置、汽車和人型機器人的應用，為未來感測器的普及提供了潛力。例如 CMOS 影像感測器易於批量化，成本相對低廉，已經廣泛使用在消費電子成像系統、安防監控、汽車主動安全(ADAS)、工業檢測以及醫療領域，根據 Stratistics MRC 的數據，預計到 2025 年，全球 CMOS 影像感測器市場規模將達到 336.4 億美元，到 2032 年將達到 643.2 億美元，預測期內複合年成長率為 9.7%。MEMS 感測器也是用途廣泛的感測器，MEMS 加速度計可以感知物體運動狀態；MEMS 陀螺儀則能夠精確測量角度變化；MEMS 壓力感測器用於檢測環境氣壓變化，輔助定位等功能。因此在消費、工業、航空、汽車、穿戴式 AR/VR 等領域得到廣泛使用。此外在消費電子領域、MEMS 麥克風可以提供高品質的通話和錄音能力。根據 Yole 的資料，2025 年全球 MEMS 感測器的市場規模約為 175 億美元左右。

研究單位 TechSearch 指出，全球封測廠將持續加碼投入先進封測資本支出，其中，薄型封裝的需求促使晶圓級封裝(WLP)持續成長。

先進封裝為半導體產業創造新契機，突破摩爾定律限制，隨著晶片製程微縮逼近物理極限，先進封裝如 3D 封裝技術，透過將晶片垂直堆疊，在有限空間內整合更多功能。提升運算效能：透過晶片堆疊和縮短彼此距離，提供更短的訊號傳輸距離與更高的頻寬，顯著降低延遲，進而提升整體運算速度。市場研究機構 Yole Group 預測，先進封裝市場規模將從 2023 年的 443 億美元成長至 2028 年的 786 億美元，年複合成長率達 12%，顯示其在產業價值鏈中的戰略地位與發展潛力。

## 2. 說明本行業之現況與發展

精材除 CIS 影像感測器與 3D 感測封裝技術外，核心競爭力在於密集的工程技術，對客戶需求能夠提供高度彈性與客製化封裝服務，以 VIA Last TSV (後製程矽穿孔) 為核心，向更複雜的晶片對晶圓堆疊而成的 SiP (系統級封裝) 邁進。

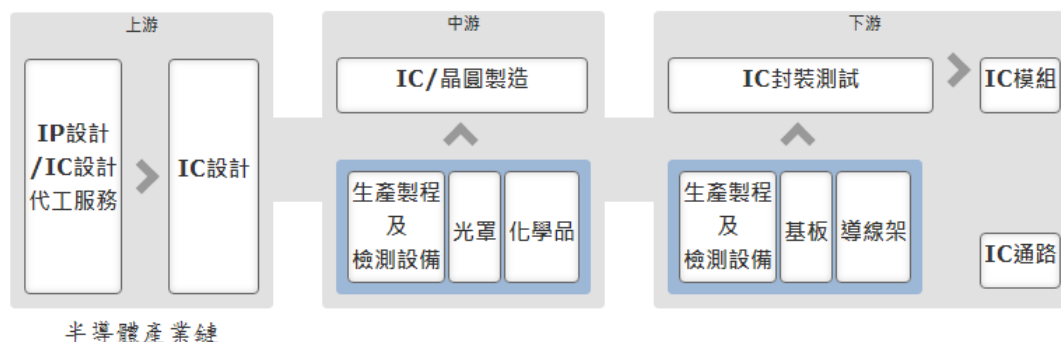
比如 8 吋會持續開發如 MEMS，光纖連結晶片等 WLPPI 的利基型服務，目前營收佔比還小，將持續開發客戶需求。

12 吋方面，目前有數家穿戴裝置相關元件客戶，因精材 WLCSP 適合輕薄短小的特性與客製化的技術服務能力，已有新的專案展開。

## 3. 產業上、中、下游之價值鏈

半導體產業鏈上游為 IP 設計及 IC 設計業，中游為 IC 製造、晶圓製造、相關生產製程檢測設備、光罩、化學品等業，下游為 IC 封裝測試、相關生產製程檢測設備、零組

件（如基板、導線架）、IC模組、IC通路等業。台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，IC設計公司在產品設計完成後，委由專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試到最終銷售都一手包辦）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給專業封裝廠進行切割及封裝，最後由專業測試廠進行後段測試，測試後之成品則經由銷售管道售予系統廠商裝配生產成為系統產品。



在後摩爾定律時代，IC產品的複雜度已難由單一半導體技術節點所實現。對IC設計業者而言，並不是每一個IP都能縮小技術節點。不同技術節點的IP或設計要混合使用，像系統單晶片（SOC）就是其中一種方法。但有時候因為不同節點成熟度不一，把不同技術的電路集合在同一顆晶片上不只成本上並不具優勢，連良率都會有影響；系統級封裝（SiP）為解決此問題而應運而生。產品owner可以把不同專長design house設計的IC運用SiP整合成同一個封裝。這種整合的彈性不只可以跨技術節點，甚至可以跨平台，把矽基材的IC與非矽基材的元件（例如III-V族或被動元件）整合在一起，開創無限可能。

這種封裝的興起，讓介於前段（Front-End）和後段（Back-End）製程之間的中段（Mid-End）製程平台擴大，除了過往所知的晶圓凸塊技術（Wafer Bumping）、晶圓級封裝（Wafer Level Package），如扇外型晶圓級封裝技術（Fan-out Wafer Level Package, FOWLP）、晶圓級尺寸封裝（Wafer Level Chip Scale Package, WLCSP）、3D WLP、WL Optics 及 3D IC 等技術型態外，還能混合這些技術以客製化各種形式的 SiP。本公司為專業晶圓層級封裝之領導者，也是第一家將三維晶圓層級封裝技術商品化的公司。

三維晶圓層級封裝技術可應用到各種不同的市場領域，包括消費性電子、通訊、可攜式電腦和汽車等。產品應用包括影像感測器、光學感測器、電源管理積體電路、功率分離式元件、類比積體電路、混合信號積體電路、微機電系統感測器、各項生物辨識晶片(如:臉部辨識器)和整合式被動元件等。

精材科技主要提供晶圓層級封裝技術(WLCSP)服務，主要應用於各式感測元件、微機電封裝及客製化晶圓級架構服務，可應用於消費電子、通訊、電腦、工業和汽車等領域。

#### 4. 產品之各種發展趨勢及競爭情形：

##### (1) 車用電子(Automotive)：

-ADAS 與自駕：隨著 Level2+及 Level 3 滲透率提升，單車搭載 CIS 數量從 2~4

顆激增至 8~16 顆。

-技術升級：廠商正競爭 800 萬甚至 1200 萬畫素的高規車用感測器，並強調 HDR (高動態範圍)與 LFM(LED 閃爍抑制)，以確保在極端光照下仍能精確辨識。

## (2) 醫療與穿戴裝置

-拋棄式內視鏡：醫療用 CIS 走向微型化與低成本。

-智慧眼鏡：隨著 Meta、小米等 AI 智慧眼鏡推出，輕量化、低功耗的影像感測器需求將在不遠的未來迎來發酵。

本公司之主要產品為影像感測器、新型生物辨識器、微機電及電源控制元件之晶圓層級封裝，目前主要競爭對手如下

主要產品	主要晶圓級封裝競爭對手
影像感測器/新型生物辨識器	晶方、華天科技、歐系 IDM

## (四) 技術及研發概況

### 1. 最近年度及截至年報刊印日止之研究發展費用

單位：新台幣仟元

項目	年度	114 年度	截至 115 年 3 月 31 日止
研發費用		323,201	80,038
營業收入淨額		7,238,545	1,913,716
占當年度營業額比重(%)		4.46%	4.18%

### 2. 所營業務之技術層次與研究發展

- (1) TSV(矽穿孔封裝)封裝技術：成功導入 CIS(CMOS Image Sensor)產品量產，並應用於 MEMS 等相關封裝製程且已完成封裝驗證導入量產。
- (2) CIS-CSP 製程改善技術：導入車規影像封裝產品，已完成車規封裝驗證導入量產。
- (3) 導入特殊光學鍍層玻璃，並應用於各式先進光學感測器。
- (4) 開發厚銅製程，成功應用於整合式被動元件產品及射頻元件產品。
- (5) 導入紅外線鍍層玻璃，並應用於手機之先進光學感測器元件。
- (6) 新一代改良矽穿孔封裝(TSV CSP)晶圓級封裝技術研發。
- (7) 開發 GaN 功率元件封裝製程，已完成客戶打樣樣品。
- (8) 新一代生物辨識感測器封裝製程開發完成，通過可靠度測試並量產。
- (9) 利用核心技術開發應用於客戶 IR sensor 特殊需求之 Si 載板蓋，並完成客戶打樣進入可靠度測試階段。
- (10) 持續利用核心 TSV 技術，搭配 Cu 導線技術啟動 12 吋封裝平台建立，已有高階影像感測晶片試量產。
- (11) 持續開發晶圓級新的製程技術，包括 Molding、TMV 等模組技術，發展 SiP 晶圓級封裝(System in WLCSP)，可應用於 AI 感測相關產業。
- (12) 截至 114 年底，本公司已取得 294 件台灣專利、209 件大陸專利、1 件德國專利、279 件美國專利及 9 件日本專利。於 114 年度，本公司新取得之專利數為：台灣專利

數 10 件，中國專利數 4 件，美國專利數 7 件，日本專利 1 件。

### 3. 最近年度成功開發之技術或產品

年度	研發成果	主要功能/效益
113	1.提供更輕薄 CIS 封裝方式，並通過可靠度測試，於 114 年進入試產階段。 2.12 吋銅導線矽穿孔製程(Cu-TSV)，以細線寬及銅導線應用於高階影像感測晶片。	產品可應用於 AR/VR 相關應用
114	1. 輕薄 CIS 封裝產品量產 2. 12 吋細線寬及銅導線矽穿孔製程 (Cu-TSV)，通過可靠度測試，進入試產階段。 3. 持續開發晶圓級新的製程技術，包括 Molding、TMV 等模組技術，發展 SiP 晶圓級封裝(System in WLCSP)。	光感測器 高階影像感測晶片。  產品可應用於 AR/VR 相關應用

#### (五) 短中長期業務發展計劃

展望 2026 年，WSTS 預測，全球半導體市場將成長 25%以上、達 9,750 億美元，所有地區和產品類別都有增長。因應市場快速變化及國內外同業競爭壓力不斷加劇，本公司特擬訂計畫如下：

##### 1.短期計畫：

###### (1) 建立以客戶導向之專業封裝服務，強化顧客滿意度

提升本公司客戶值得信賴的高品質服務，以更快、更好的技術與服務，滿足客戶的需求；並在晶圓級製程平台上提供更多樣的封裝技術，以因應多元化產品的需求。

###### (2) 加強上、中、下游產業鏈之合作

先進製程需求越來越高，上、中、下游之合作與整合是先進高階製程能否成功之重要關鍵，精材科技致力與晶圓代工業者及測試大廠共同策略聯盟，並與國際整合元件製造大廠之技術合作開發，致力於成為先進晶圓級尺寸封裝技術服務之領導廠商。

###### (3) 健全公司經營體質，以職能為培育核心，提昇管理及經營績效

透過教育訓練達成公司經營策略目標，以提升管理及技術專業為訴求，有效發揮職能作為培育核心，並以改善工作成效為導向，進一步提升員工工作效率，使公司能因應環境的快速變化與不斷的挑戰。

##### 2.中長期計畫：

###### (1) 深耕產業合作，共創雙贏價值

注重客戶與供應商長期合作發展關係。強調與上下游廠商的長期合作，在產業專業分工的趨勢中，本公司將成為客戶信賴的封裝加工廠，提供客戶需要的品質與服務，同時也與供應商建立良好的合作關係。

###### (2) 技術創新驅動，研發先進製程

致力於衍生製程與新製程之研究發展，如先進 3D 晶圓層級堆疊之應用、新生物辨識產品之應用、矽晶圓連接之載板、各種微機電產品之應用等。產品之類別將從消

費、汽車、電腦等擴展至監控、醫療等電子產業。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1.主要商品銷售地區

單位：新台幣仟元

地 區	年 度	114年度	
		金 額	%
亞	洲	7,108,713	98
歐	洲	121,798	2
美	洲	8,034	0
合	計	7,238,545	100

#### 2.先進封裝市場分析與市佔率

半導體產業持續轉向先進封裝(AP)，將其作為創新的關鍵。AP 增強產品功能性、提昇效能並降低成本。AP 的趨勢包括小晶片分割(chiplet)和 2.5D/3D 封裝，以提高產量並降低成本。根據 Statistics MRC 的數據，全球先進封裝技術市場預計在 2025 年達到 295 億美元，到 2032 年將達到 506 億美元，預測期內的複合年成長率為 8.0%。

先進封裝技術專注於創新的半導體封裝解決方案，例如 2.5D/3D IC、覆晶、晶圓層次電子構裝和異質整合。這些技術可提升家用電子電器、通訊、汽車和工業應用領域設備的性能、能源效率和小型化程度。對高效能運算、物聯網設備和小型化電子產品日益成長的需求正在推動這一領域的成長。溫度控管互連技術和製造流程的進步，加上產業研發投入，正在推動全球先進封裝解決方案的採用。

微型化和高性能需求是先進封裝的核心驅動力。隨著裝置尺寸的縮小和運算密度的提升，設計人員正在尋找能夠縮短互連長度、改善散熱並實現邏輯、記憶體和感測器異質整合的封裝。此外，覆晶、晶圓級扇出和 3D 堆疊技術能夠滿足 AI 加速器、行動處理器和高頻寬記憶體所需的電氣和熱性能。這種融合迫使代工廠、OSAT 和 OEM 採用先進的基板和穿透矽通孔，並在設備和製程開發方面投入巨資，以滿足更嚴格的可靠性和產量比率目標，並降低製造過程中的差異性。

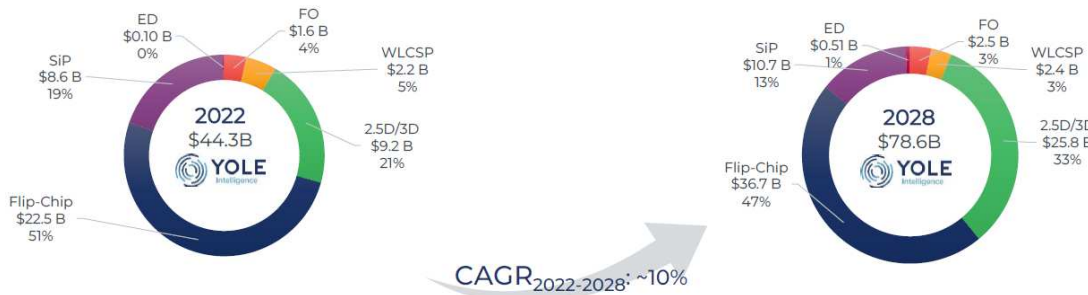
預計亞太地區將在預測期內佔據最大的市場佔有率。這一優勢得益於其豐富的生態系統，包括代工廠、OSAT、基板製造商和材料供應商，這些供應商主要集中在台灣、韓國、中國大陸、馬來西亞和日本。強而有力的政府獎勵措施、本地專業知識和現有規模加快了新封裝流程的上市時間，而靠近主要 OEM 廠商和超大規模資料中心業者的地理位置則確保了高產量需求。此外，持續的產能和人才發展投資支持了產量的持續成長，進一步吸引了資本、技術夥伴關

係和人才庫。

預計亞太地區在預測期內將呈現最高的複合年成長率，因為各國政府和產業正在加快對封裝、測試和基板能力的投資，以從下一代半導體中獲取價值。在馬來西亞、中國大陸、台灣和韓國，產能擴充和激勵計畫正在推動混合鍵合和扇外型晶圓級封裝等先進封裝製程的快速發展。此外，人才、設備供應商和超大規模資料中心業者的集中正在縮短認證週期，並提高新封裝架構的採用率。與關鍵客戶的區域合作正在加速商業化進程，這將在預測期內顯著推動區域成長。

使用封裝來提高電子系統的性能、可靠性和成本效益，正在推動各個行業終端用戶垂直領域的需求不斷成長，而整合度、能源效率和產品特性的不斷進步則推動著市場的成長。根據Yole Group數據顯示，2025年全球封裝市場規模占比超過傳統封裝來到51.03%，並於2028年先進封裝市場規模將上升至786億美元，先進封裝市場占比將達到55%，年複合成長率(CAGR)達10.05%。

### ADVANCED PACKAGING REVENUE FORECAST 2022-2028



本公司目前服務項目包含晶圓級尺寸封裝，晶圓級後護層封裝等均屬先進封裝市場範疇，後續配合前端晶圓製程微縮與客戶應用整合開發相對因應新封裝與製程，持續擴大先進封裝市場佔有率。

### 3.市場未來之供需狀況與產品之各種發展趨勢

短期來看，市場受惠於高階手機復甦與車用需求穩定；長期來看，感應器的價值將從「像素高低」整合進「AI感知能力」。台灣的相關供應鏈如台積電的代工、精材的封測在這一波高價值、高門檻的感測器浪潮中仍佔有戰略優勢。

本公司主要服務為晶圓層級之封裝代工服務，應用產品包含行動裝置、5G通訊、汽車電子及穿戴式裝置等應用。其主要應用領域之供需狀況與成長性分析如下：

#### (1)生物辨識器(Biometric Sensor)

生物辨識(Biometric)是指透過人體指紋、臉部、聲音、虹膜、甚至於人體 DNA 分子等身體器官組織的獨特性，來辨識使用者身分的一項技術。根據 Statistics MRC 預測，2023 年全球臉部辨識市場規模將達 66 億美元，預計 2030 年將達到 224 億美元，預測期內複合年成長率為 19.2%。臉部認證是一種生物辨識技術，透過分析和比較臉部特徵模式來識別和驗證個人。該技術使用演算法來映射獨特的特徵，例如眼睛之間的距離、鼻子的形狀和下巴輪廓，以創建面部特徵，通常稱為面部指紋。將這些臉部

指紋與資料庫中儲存的臉部指紋進行比較，或與現實生活中的影像進行比較，以驗證和識別該人。此外，臉部認證也用於解鎖智慧型手機和其他設備，提供方便且安全的身份驗證方法。

## (2) 影像感測器(CIS:CMOS Image Sensor)

CIS無疑是許多創新應用的關鍵元件之一，從手機的前後鏡頭、數位相機/攝影機，到遠程醫療、無人載具等新興應用層面，再到安防監控系統、製造業視覺檢測等傳統領域，影像感測器的無所不在，正成為推動各行業邁向智慧化、自動化的重要核心技術。CIS總是在背後扮演了將光訊號轉換成數位影像資訊的關鍵角色。影像感測器不僅用於數位相機與智慧型手機等一般家電產品，還運用於監視攝影機與車載攝影機、醫療用攝影機等特殊用途的攝影機裡。

依據Research Nester 2024年影像感測器市場規模超過283.4億美元，預計2037年底將達到799億美元，在預測期內(即2025-2037年)複合年增長率約為8.3%。

## (3) 微機電感測器(Micro-Electro-Mechanical Systems, MEMS)

微機電系統(MEMS)可作為感測器或致動器(actuator)使用，具備體積小、低功耗、靈敏度與可靠性高等優勢，目前已成為日常生活中各式產品不可或缺的重要零組件，應用範疇含蓋消費性電子醫療、健康、國防、電信、工業等重要產業領域。例如：慣性感測器、壓力感測器等能應用於智慧手錶等穿戴式裝置上，進行個人生理參數監測，或可應用於產線上，監測生產製造流程，以確保產品品質；MEMS麥克風、揚聲器與光學MEMS(Optical MEMS)則能應用於AR/VR眼鏡與真無線藍牙(True Wireless Stereo, TWS)耳機上。

根據Yole Development產業分析報告，MEMS的整體發展趨勢除了持續朝向尺寸微縮與成本降低以外，其他重要趨勢包括：開發新材料，例如氮化鋁(AlN)、PZT等壓電陶瓷材料，以提高裝置性能、靈敏度並降低功耗；與人工智慧結合，發展智慧感測系統；利用先進封裝技術，如系統級封裝(System in a Package, SiP)，將IC、感測器、電源、計算等元件整合至同一系統中，以降低系統尺寸、提高能源使用效率並且實現更多功能。

依據 GII Global information MEMS市場規模預計到2024年為168.1億美元，預計到2029年將達到251.9億美元，在預測期內(2024-2029年)複合年成長率為8.43%。

## 4. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

### (1) 競爭利基

#### a. 生產效率提升，降低成本提升競爭優勢

近年積極加速設備自動化、產線流程優化以提升生產力產能稼動率，並整合資源利用各廠區產能機動調配之方式，快速提供產品及服務，取得客戶長期穩定之信賴。

#### b. 技術領先暨產品應用多樣化

精材科技深耕晶圓層級封裝市場，致力技術研發及擴展產品應用，除品質優良、交期迅速、售後服務良好深受客戶信賴外，市場行銷與研發團隊建立完整的新技術

專利，並配合客戶產品需求開發出多種先進之晶圓層級封裝，並獲得國際品牌大廠認證之合格供應商。

#### c.集團整合

本公司為台積電轉投資公司，不僅利用本身之技術與行銷能力，建立強大之客戶群，更結合台積電半導體製造技術與本公司在下游提供晶圓級封裝的專業技術，於半導體供應鏈中可提供客戶完整之一條龍服務(Turn-key service)，與客戶形成長期的伙伴關係，不斷正向循環。

#### d.國際分工之優勢

台灣封裝業的發展，扮演全球半導體業供應鏈的夥伴，藉先進技術發展策略，並整合品質、成本、交期、產能及服務之總體運籌優勢，締造在國際分工體系中的總體競爭地位。本公司為先進晶圓層級封裝服務之提供者，不僅提供國內外客戶封裝服務，並藉由與晶圓代工公司合作，提供完整之供應生產鏈體系，解決生產過程衍生之相關議題。

### (2)發展遠景之有利因素

#### a.先進晶圓層級封裝之成長

因應終端產品需求，晶圓層級封裝製程發展不斷往前推進，目前封裝產品追求的製程目標包括：尺寸縮小、功率降低、功能與頻寬增加，以期超越摩爾定律，希望將半導體元件與模組的功能性與整合度發揮到極致。從技術發展脈絡可以發現，半導體封裝產業不斷在追求可以減少晶片厚度及材料成本、提升晶片效能、降低電磁干擾與功率消耗的3D堆疊封裝技術。面對晶圓層級封裝趨勢所帶動的市場機會，臺灣因半導體產業鏈完整，因此具有晶圓層級封裝生態發展優勢。預計未來晶圓層級封裝技術應用領域將會十分寬廣。

#### b.開發新利基應用，持續投資中長期商機

鑑於產業需求變動快速，本公司持續拓展新客戶與新利基產品之開發，如拓展5G GaN 通訊用高頻功率元件加工服務及新客戶、客製化微機電元件加工服務、持續開發元件薄化製程與新創模組技術，協助客戶新創產品需求，持續12吋晶圓測試業務。

#### c.關鍵技術之自主研發

本公司持續強化研發能量，汽車電子相關之晶圓級後護層封裝及晶圓級尺寸封裝，由於產品品質優異，獲得多家國際級品牌大廠及汽車廠之合格供應商。另本公司近年亦開發多種微機電感測器、指紋辨識感測器、新型生物辨識感測元件之晶圓級後護層封裝及晶圓級尺寸封裝技術，此等技術可達成產品輕薄短小之需求，對新興之行動裝置及穿戴式裝置之輕量化有極大助益。

### (3)發展遠景之不利因素及因應之道

#### a.智慧手機趨於飽和，消費者換機週期延長

智慧型手機市場面臨產品成熟、產品差異化降低、市場滲透率已高，新興市場採購動能支撐成長等不利因素，讓手機產業經營相對困頓。

因應對策：

因應電子產業及半導體產業市場與其技術的不斷變化，本公司的競爭利基為持續開發先進製程與新衍生技術並搭配新興應用之需求，強化與關鍵客戶合作並整合上游產業龍頭技術，提供客戶高附加價值之封裝解決方案，並確保客戶產品即時導入市場，持續精進製造管理以提高生產力並降低營運成本。

**b. 中美貿易戰牽動地緣政治和半導體產業發展**

中美貿易戰雖因取得暫時性共識而降溫，但貿易戰火可能隨時重啟，使全球經濟動能仍面臨不確定性。

半導體 232 調查的行政措施透過關稅豁免、關稅抵銷計畫，原本已大幅降低對半導體及衍生品相關供應鏈衝擊，但美國關稅政策又面臨最高法院裁定的不確定因素仍將對經貿及產業發展造成影響。

因應對策：

本公司聚焦發展先進晶圓層級封裝，因應各種功能應用來達到產品差異化的效果，導入自動化設備，提升生產力及品質，並有效降低成本。轉進利基應用市場，包括醫療、汽車、監控電子等領域。對於類比、感測器等晶片出現高度需求，強力佈局專利地圖，以提升並拉大競爭力之差異化。同時強化台美產業供應鏈整合、緊密雙方的經貿夥伴關係，並發展多元化的國際市場。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

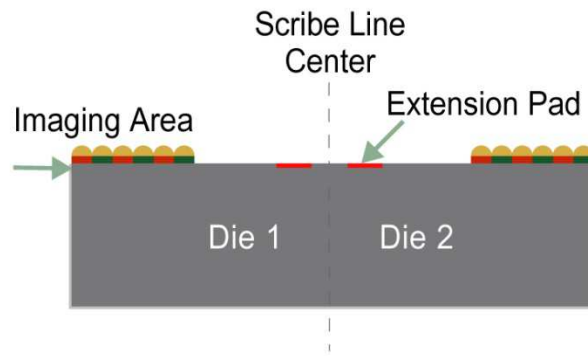
產品別	主要用途	主要應用領域
晶圓級尺寸封裝	影像感測器、環境感測器、生物辨識感測器	手機、平板、筆記型電腦、汽車、醫療、擴增實境(AR)、虛擬實踐(VR)
晶圓級後護層封裝	作動感測器、微機電元件、功率、類比及 RF 元件	手機、平板、筆記型電腦、汽車

2. 主要產品產製過程

(1) 晶圓級 CSP 封裝技術製程：

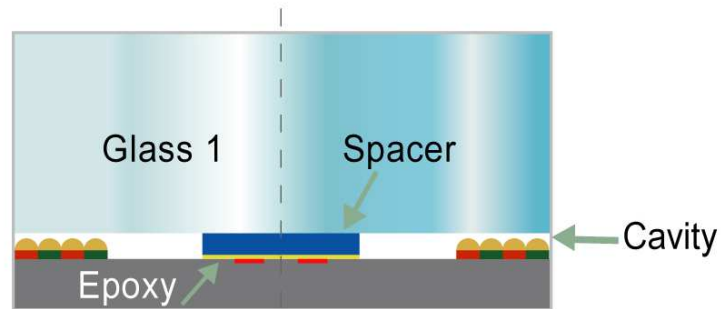
在晶片尚未切割前即進行，整片晶片經由薄膜，黃光及蝕刻等晶圓製程完成封裝，最後再切割成單顆的 IC，此種製程可視為前段半導體晶圓廠製程的延伸。最大優點是在封裝的過程中，藉由整片晶片的製程方式，但卻同時將個別的 IC 封裝完成來降低封裝過程中的支出。整個封裝製程的基本步驟如下列所述：

- A. 以黏著劑將一片高透光性之薄玻璃黏貼於客戶晶片的正面，以保護晶圓表面不受污染。



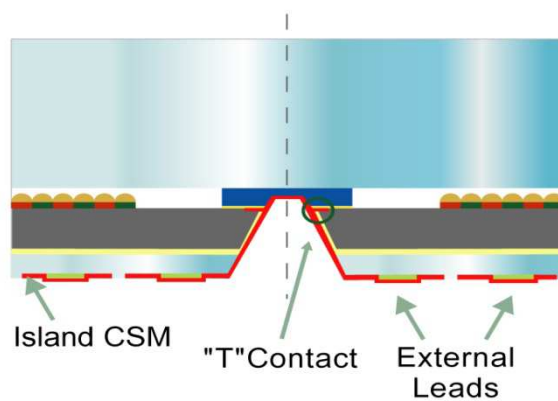
**Step A: Passivation and Pad Extension Layers**

- B. 研磨黏有玻璃的晶片背面，使晶片的厚度變薄，藉此降低之後的封裝厚度，並以蝕刻的方式將晶片切割道背面的矽材料去除，使一顆顆獨立 IC 產生於黏著的玻璃保護片上。



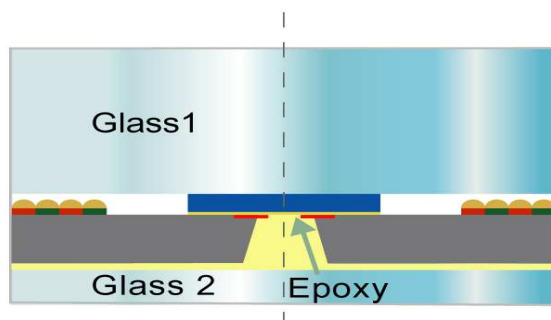
**Step B: Glass 1 Attachment**

- C. 將玻璃保護層黏貼於晶片背面，以達到完全包覆 IC 的保護作用。



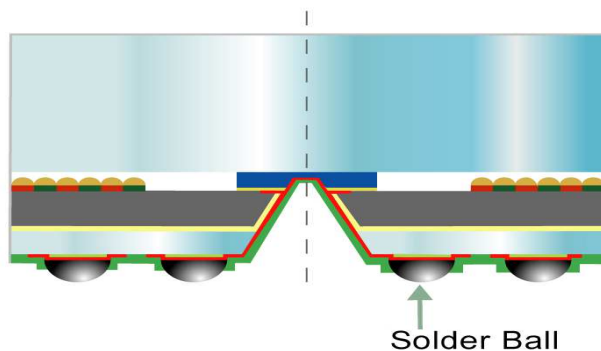
**Step C: Etching and Glass-2 bonding**

- D. 在玻璃表面準備製作銲接點(Solder Joint)的所在位置覆上一層有機材料，以作為絕緣緩衝層。



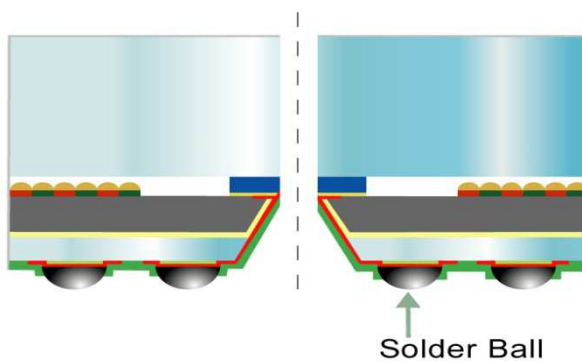
**Step D: Barrier deposition and T-contact formation**

- E. 在個別的 IC 之間切割露出 IC 銲墊的截面並濺鍍上金屬層，再利用三度空間之曝光、顯影及蝕刻等製程完成所需的金屬線路，使線路與 IC 銲墊的截面相連通。



**Step E: Passivation coating and BGA formation**

- F. 在金屬線路上覆蓋上一層保護層。



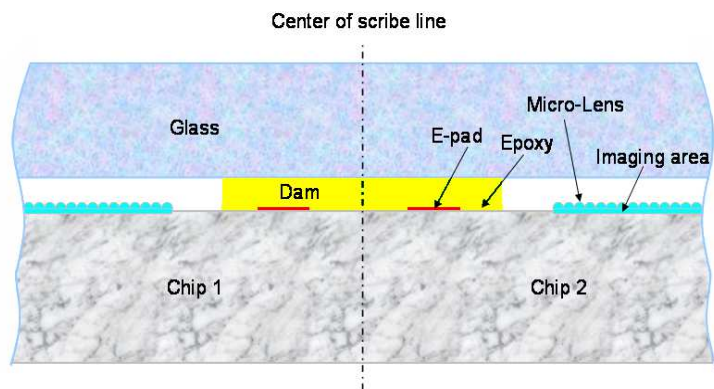
**Step F: Dicing and Final inspection**

- G. BGA 型式的元件則以印刷的方式將錫膏印在整片晶片上銲接點的所在位置，再經過迴銲(Reflow)形成錫球。

- H. 切割晶片成為單顆封裝完成的 IC。

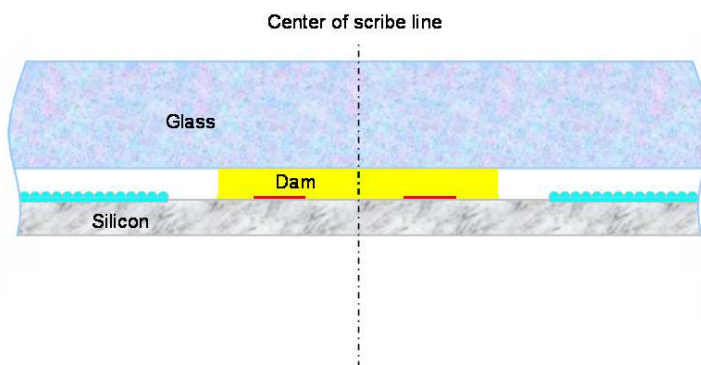
(2) TSV(矽穿孔封裝)技術步驟說明：

A. 以黏著劑將一片高透光性之薄玻璃黏貼於客戶晶片的正面，以保護晶圓表面不受污染。



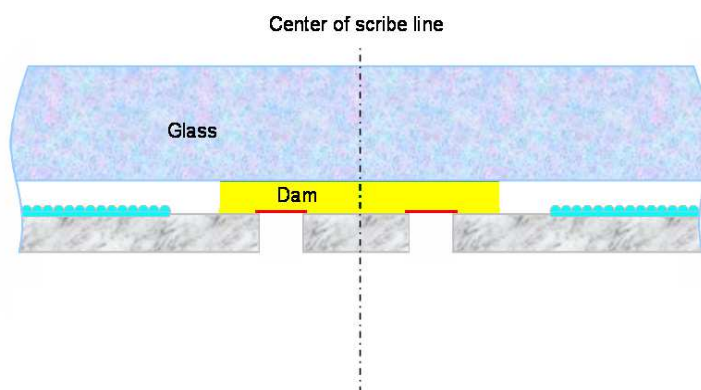
**Step A: Glass attachment**

B. 研磨黏有玻璃的晶片背面，使晶片的厚度變薄，藉此降低之後的封裝厚度。



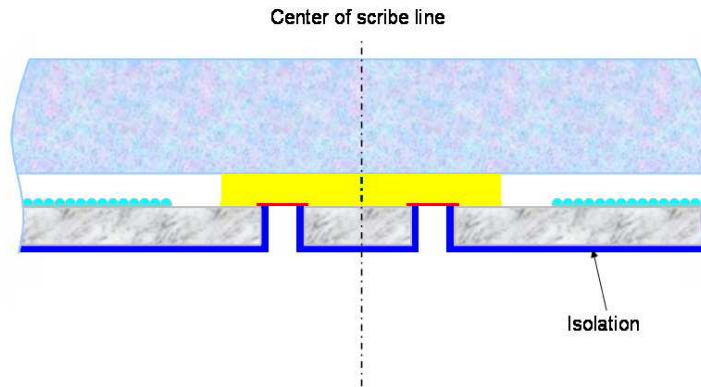
**Step B: Wafer thin down**

C. 以蝕刻的方式從晶片背面的矽材料去除，作為 RDL 線路連接之孔洞。



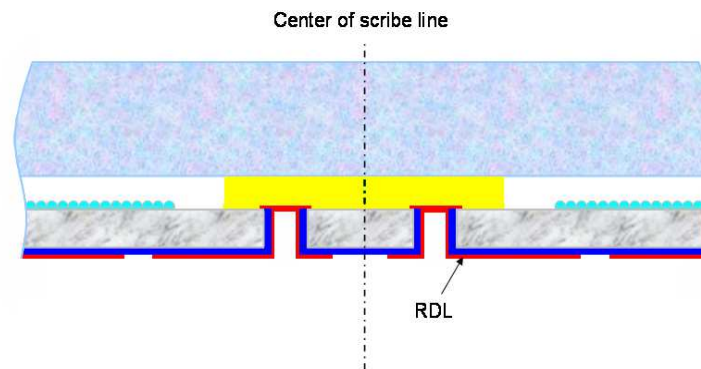
**Step C: TSV formation**

D.在晶片表面覆上一層二氧化矽作為絕緣層。



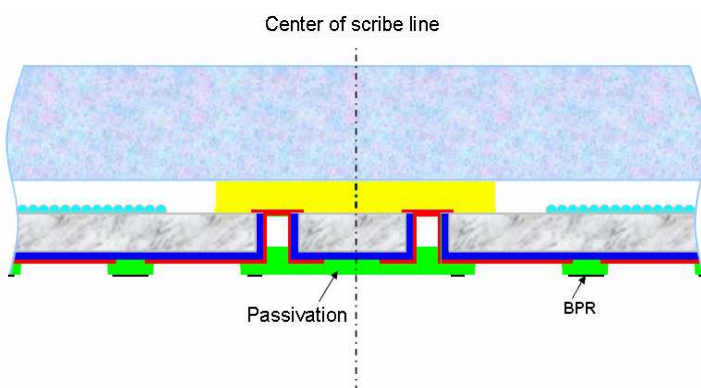
**Step D: Isolation formation**

E.在晶片表面濺鍍上金屬層，再利用三度空間之曝光、顯影及蝕刻等製程完成所需的金屬線路，使線路與 IC 鉗墊的截面相連通。



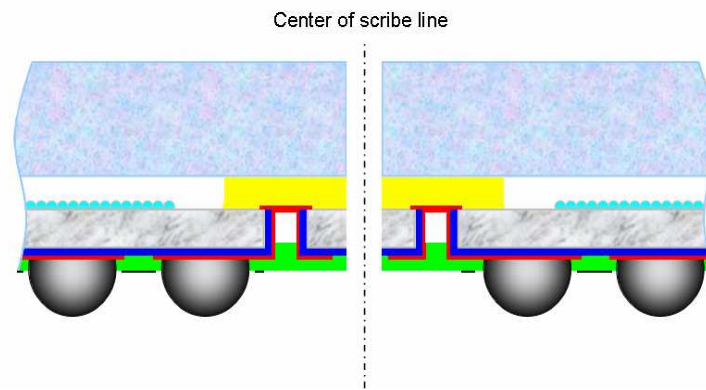
**Step E: RDL process**

F.在金屬線路上覆蓋上一層保護層。



**Step F: Passivation process**

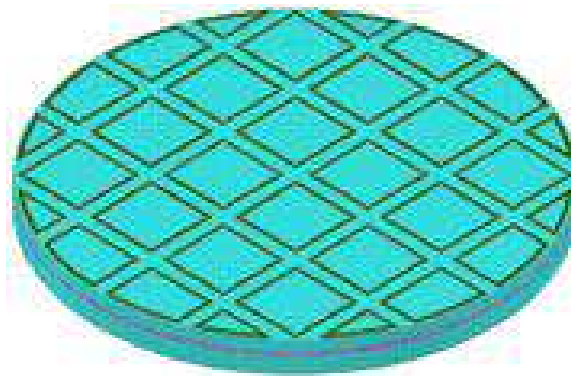
G. BGA 型式的元件則以印刷的方式將錫膏印在整片晶片上銲接點的所在位置，再經過迴銲(Reflow)形成錫球。最後切割晶片成為單顆封裝完成的 IC。



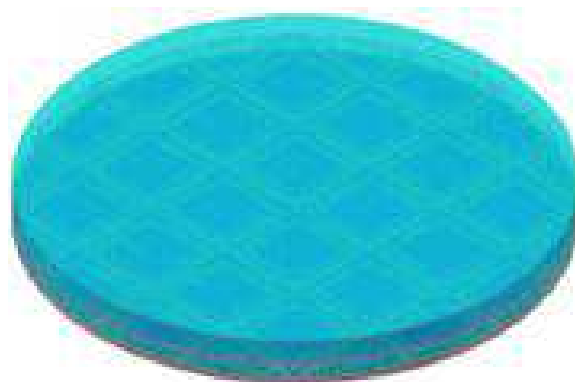
**Step G: BGA & Dicing processes**

(3) CIS IR glass 模組封裝步驟說明：

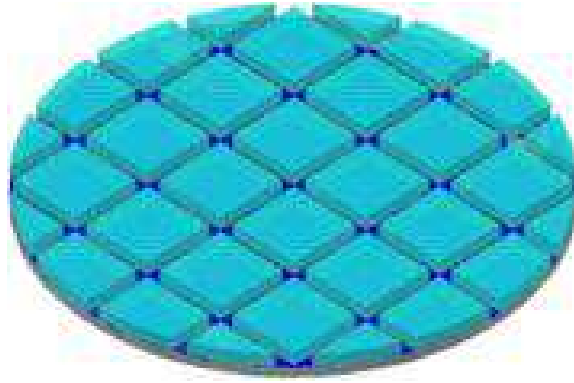
A. IR glass 模組化



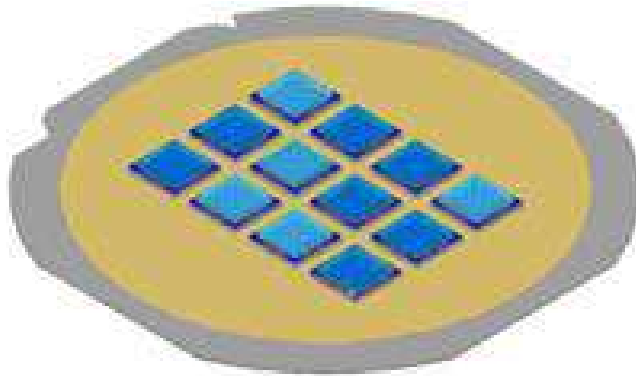
B. Si device 和模組化 glass 結合



### C. Si device 薄化和切割

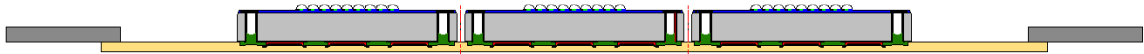


### D. 重新排列後以 frame type 出貨



### (4) Glassless TSV 技術說明：

配合 TSV(矽穿孔封裝)技術發展 Glassless & LGA 技術包裝出貨



### 3. 未來研發計畫：

配合市場以及客戶感應器(Sensor 和 MEMS)的新產品技術需求，持續開發晶圓級新的製程技術，包括 Molding、TMV 等模組技術，應用於多樣生物辨識感測器、影像感測器、環境光源感測器、微機電(MEMS)、功率場效電晶體及新興 AI 感測等產品，提供包括晶圓級封裝以及中後端晶圓級製程的技術服務。

## (三) 主要原料之供應狀況

主要原料	供應商名稱	國外	國內	供應情形
薄型玻璃	SCHOTT、NEG	✓		良好
靶材	優美科、有研、臺灣萬騰榮		✓	良好
鍍金液	OKUNO	✓		良好
綠漆	台灣道邦		✓	良好
研磨液	瀚軒		✓	良好

## (四) 最近二年度主要進、銷貨客戶名單：

## 1.最近二年度占進貨總額百分之十以上之進貨廠商名稱、金額與比例：

單位：新台幣仟元

項目	113 年				114 年			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD.	207,461	23	無	NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD.	243,248	26	無
	其他	700,264	77		其他	677,344	74	
	進貨淨額	907,725	100		進貨淨額	920,592	100	

## 2.最近二年度占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱、金額與比例：

單位：新台幣仟元

項目	113 年度				114 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A 公司	5,324,805	75	具重大影響力之投資者	A 公司	5,386,458	74	具重大影響力之投資者
2	B 公司	1,246,065	18	無	B 公司	1,196,587	17	無
	其他	489,071	7		其他	655,500	9	
	銷貨淨額	7,059,941	100		銷貨淨額	7,238,545	100	

### 三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年 度		113 年度	114 年度	當 年 度 截 至 115 年 3 月 31 日
員 工 人 數	直 接 人 員	812	899	954
	間 接 人 員	633	641	646
	合 計	1,445	1,540	1,600
平 均 年 歲		39	39	39
平 均 服 務 年 資		9.1	9.0	8.8
學 歷 分 布 比 率	博 士	19	19	18
	碩 士	281	283	274
	大 專	797	906	982
	高 中	315	303	298
	高 中 以 下	33	29	28

### 四、環保支出資訊

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容）：113年度及114年度均無造成環境污染違反環保法令遭處分情事。

(二) 目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：不適用。

本公司除依環保法規規定操作與維護廢水處理設備、空氣污染防治設備與廢棄物分類與管理外，並持續關注國際環保發展趨勢，致力規劃與執行各項節能減碳專案，以減少各項目用電及溫室效應氣體排放量，以降低地球溫室氣體效應，善盡地球公民職責。

本公司已通過ISO 14001環境管理系統、ISO 45001職業安全衛生管理系統、TOSHMS臺灣職業安全衛生管理系統驗證及環境部溫室氣體排放量查證，並且每年藉由內、外部稽核與第三方定期覆核檢視是否符合持續改善之目的，以致力達成公司環安衛政策(客戶至高滿意、安全零事故、環境永續發展)。

### 五、勞資關係

(一) 公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

#### 1. 員工福利措施：

- (1) 本公司已依照「職工福利金條例」之規定，提撥福利金，組織職工福利委員會，辦理職工福利事項，從業人員得享有各項福利措施及年節獎金。
- (2) 本公司從業人員一律參加全民健保、勞工保險及團體保險，享有各項保險給付權利等。
- (3) 本公司每年發放年終獎金，於年度結算時，如有盈餘，除繳納稅捐彌補虧損及提撥股息、公積金外，依年度考核之結果及相關制度配發員工酬勞。
- (4) 本公司訂有獎金發放制度，總經理會視實際營運成果，發放特別激勵獎金。

#### 2. 員工學習與發展：

培育專業人才、改善人力素質一直是本公司秉持的信念。為增進員工工作技能、讓員工快速融入工作環境、改善產品與服務品質、提升組織整體競爭力，本公司透過系統

化的訓練藍圖展開教育訓練計劃，並且規劃員工職務發展之學習地圖，讓員工與公司一同成長。

114 年度共舉辦了 36 個班次的實體訓練課程，總訓練時數為 270.11 小時，總參與人次為 868 人次。另外，錄製及重製共 36 堂專業技術的數位課程，總時數為 14.06 小時。

訓練類別包含：

(1)新進人員訓練

由人資單位安排新進人員訓練活動，內容包含公司簡介、環安衛介紹、品質與環境限用物質管理系統介紹。

(2)個人效能訓練

為提升個人工作能力、加強工作技能，以提升工作效率，規劃個人效能提升課程，如簡報技巧、溝通技巧等相關課程。

(3)技術訓練

為強化研發能力與改善產品技術以增加公司競爭力，提供技術類專業訓練課程，以強化工程與研發人員之專業技術能力。

(4)OJT 訓練

為使工程技術得以傳承，透過工作中學習，以培養技術人才，確保產品品質。

(5)管理學習

根據不同階層的管理職能，系統化的規劃管理人員學習計劃，並依此展開相關的管理課程。

(6)特定資格人員訓練

依相關法令規定或工作需求辦理特定資格人員訓練，並定期檢定，以增進工作技能，進而提升產品之品質。

3.退休制度：

依勞動基準法相關規定，按每月薪資總額百分之二提撥員工退休準備金，專戶存入臺灣銀行信託部。並依勞動基準法規定，辦理員工退休金支付。截至 114 年底本公司臺灣銀行退休金專戶已存入新台幣 66,025 仟元。自 94 年 7 月 1 日起，員工選擇適用勞工退休金條例之退休金制度者，按其每月薪資百分之六提撥至勞工保險局之個人退休金專戶，於 114 年認列費用之金額為新台幣 57,068 仟元。

4.勞資間之協議情形：

本公司制訂工作規則、人事管理規則及人事作業準則，從員工進用、升遷至退休、撫卹福利皆有完整規劃，作為公司與員工共同的規範，勞資的協調均透過勞資會議、員工溝通、建立多元溝通管道，暢通的工作環境，並積極促進勞資雙方和諧與共贏。

5.工作環境與員工人身安全保護措施：

公司依法建置完善之職業安全衛生管理制度，持續提供安全之工作環境，並落實廠區安全管理、門禁管制及防災應變機制。另推動員工人身安全保護與不法侵害預防措施，透過教育訓練、通報與關懷機制，確保員工於工作期間之安全與尊嚴，落實企業永續發展責任。

6.僱員關懷：

不定期舉辦員工滿意度調查，用以了解員工對訓練發展、工作適應、人權管理等制度之滿意度。

## 7. 隱私管理：

本公司依據個人資料保護法訂有個人資料保護管理程序，建立精材公司執行業務或管理個人資料保護遵循之依據。此外，每季進行私隱管理的法規與客戶規定鑑別，以確保公司內部辦法與實際作為皆符合相關規定，並識別私隱管理的風險。

(二) 最近年度及年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

## 六、資通安全管理

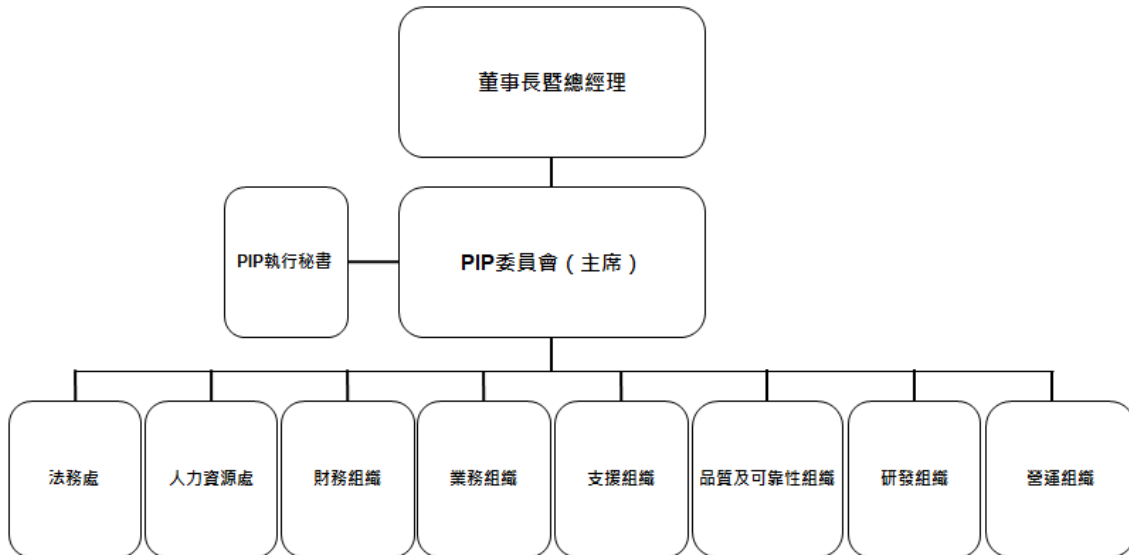
### (一) 資訊安全治理制度與策略

精材公司為保障公司及客戶之機密資訊安全，本公司自民國 97 年 1 月設置「機密資訊保護委員會(Proprietary Information Protection Committee, PIP Committee)」，負責機密資訊安全管理及監督，並制定「機密資訊保護政策」及「機密資訊保護作業管理辦法」，明定公司機密資訊保護的管理政策、程序及規範作業。同時，為建構完善的治理制度與全方位的資安防衛能力，PIP 委員會偕同資訊部門每季定期召開會議，檢視資安政策及執行成果，且每年定期向董事會報告資安治理概況，透過資安技術運用，識別資安風險與弱點改善，提升同仁對資訊安全保護的正確觀念及警覺性，降低機密資訊外洩及網路病毒攻擊的風險，維持公司競爭優勢。為順應資安趨勢，健全公司資安標準作業程序，確保面對威脅時具備即時應變韌性，本公司於民國 114 年 9 月取得 ISO27001 資訊安全管理系統認證，證書效期為民國 114 年 9 月 3 日至 117 年 9 月 2 日。為推行資安政策，制定五大資訊安全行動目標，落實 PDCA 循環：

1. 建立與落實機密資訊及資訊安全管理系統。
2. 遵守法規與合約之機密資訊及資訊安全要求。
3. 落實員工與相關團體機密資訊保護及資訊安全教育及宣導。
4. 評估與鑑識風險並設定改善目標與控制措施。
5. 透過內部稽核活動持續改善機密資訊及資訊安全管理系統。

### 資訊安全組織架構：

1. PIP 委員會：由各組織主管指派代表組成，負責全公司的機密資訊管制作業之研議、建置、稽核與推動等事項。
2. PIP 執行秘書：負責機密資訊管制、規劃、監督及推動執行。
3. 資訊部門：負責資訊安全系統建置與管理，並依 PIP 委員會決議及需求協助評估、建置及管理資訊安全軟、硬體，並進行資料通訊及儲存行為之異常分析，若有異常則以資安通報呈報 PIP 委員會處理。



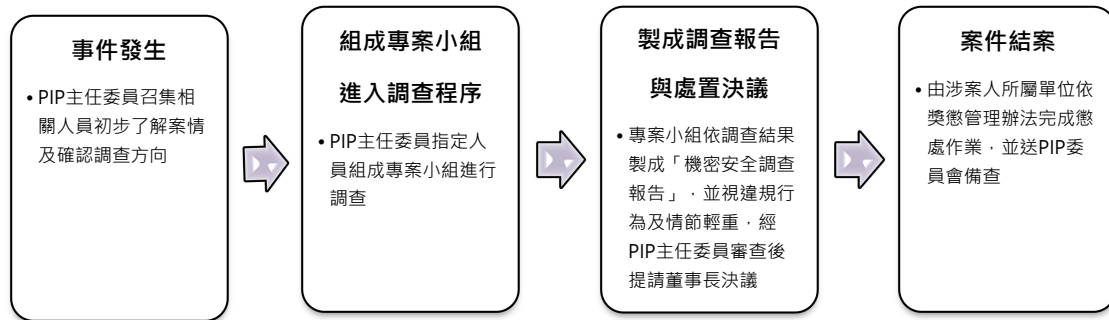
2025 年度資安風險管理對策及投入之資源：

1. 取得 ISO 27001 證照，建立標準化流程。
2. 機密資訊盤點、分類分級及標示，並建置系統避免機敏資訊外流。
3. 重要供應商資安問卷調查及拜訪交流。
4. 強化外部資安防禦設備以預防零時差攻擊及阻斷釣魚郵件。
5. 實施網頁瀏覽隔離，確保員工上網安全。
6. 郵件審核與 DLP 系統管制，防止機敏資料外流。
7. 制定資訊系統企業持續營運及災害應變計劃及演練，並明確訂定核心業務之復原時間目標(RTO)及資料復原時間點目標(RPO)，設置適當之備份機制及備援計畫。
8. 社交工程-增加可疑郵件識別機制、釣魚郵件演練與案例宣導。
9. 定期宣導及進行查核活動，以確保公司的機密資訊保護措施的落實。
10. 強化資安防禦能力與第三方外網資安弱點評鑑及弱點改善。
11. 定期展開危害鑑別、風險評估及改善作業。
12. 強化伺服器防護、管理及異動機制。
13. 建置資訊安全監控中心 SOC，即時掌控公司資訊安全狀態，專注於資訊安全警訊、警戒提升處置及資安事故發生時之指揮中心。
14. 建置 SIEM (Security Information and Event Management)，集中各系統所蒐集紀錄，整合事件告警、關聯分析、產出數據報表，以輔助資安人員更有效率地建立整體環境可視性並即時排除問題。

2025 年度教育訓練與稽核：

1. 累計完成 12 次 PIP 管理會議及 4 次 PIP 委員會議。
2. 公司全員完成 PIP 教育訓練及稽核。
3. 資訊安全人員累計完成 35 場次資安教育訓練。

資訊安全事件調查程序：



(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

最近年度及截至年報刊印日止無因重大資通安全事件所遭受之損失。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
租賃契約	經濟部	113/2~118/2	中壢工業區 A 棟(A5-3)	不得轉租、出借或以其他方式供他人使用。
		113/2~118/2	中壢工業區 A 棟(A1-3,A1-4, A2-4)	
		110/4~116/4	中壢工業區 A 棟(A4-3)	
		102/1~115/10	中壢工業區 C 棟(C7-1,C7-2)	
		102/1~116/11	中壢工業區 C 棟(C9-1,C9-2)	
		101/3~117/02	中壢工業區 C 棟(C10-1,C10-2)	
		99/5~119/4	中壢工業區 A 棟(A5-4、A7-2)	
		110/1~121/8	中壢工業區 A 棟(A1-1)	
	宏惠光電	109/11~119/12	中壢工業區 A 棟(A3-3, A3-4)	
新創人工智能	115/4~117/3	中壢工業區 C 棟(C2-2)		
借款合約	遠東銀行	112/11~117/11	營運週轉	無
	遠東銀行	112/12~117/12	中期專案貸款	應遵守專案貸款要點，不得移用貸款。
	台北富邦銀行	113/03~118/02	中期專案貸款	應遵守專案貸款要點，不得移用貸款。
後段服務合約	台灣積體電路製造股份有限公司	102/6~(註 1)	後段封裝服務	保密責任
設備寄託合約	台灣積體電路製造股份有限公司	108/10~109/10 (註 2)	寄託供後段測試封裝之設備	保密責任
Collaboration Agreement	台灣積體電路製造股份有限公司	108/11~113/11 (註 3)	後段晶圓測試代工業務	保密責任 賠償責任

註 1：本契約至任一方重大違約，經他方終止為止。

註 2：本契約自生效日起算一年，除另有規定外，自動展延一年，其後亦同。

註 3：本契約自生效日起算五年，除提前終止外，自動展延一年。

## 伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況

國際財務報導準則：

單位：新台幣仟元

項目	114 年度	113 年度	差異	
			金額	變動比率
流動資產	6,391,546	6,765,340	(373,794)	(5.53)
不動產、廠房及設備	8,551,702	5,768,982	2,782,720	48.24
無形資產	19,459	14,532	4,927	33.90
其他資產	247,010	281,151	(34,141)	(12.14)
資產總額	15,209,717	12,830,005	2,379,712	18.55
流動負債	2,553,241	2,009,562	543,679	27.05
非流動負債	2,898,864	1,729,417	1,169,447	67.62
負債總額	5,452,105	3,738,979	1,713,126	45.82
股本	2,713,643	2,713,643	-	-
資本公積	396,424	396,424	-	-
保留盈餘	6,647,545	5,980,959	666,586	11.15
其他權益	-	-	-	-
權益總額	9,757,612	9,091,026	666,586	7.33

重大變動項目說明(變動達 20%以上者)：

1. 不動產、廠房及設備增加主要係房屋及建築增加 4,521,455 仟元、機器設備增加 1,018,655 仟元、其他設備及辦公設備增加 829,544 仟元、未完工程及待驗設備減少 2,662,783 仟元及累計折舊增加 926,705 仟元。
2. 無形資產增加主要係專利權增加 5,082 仟元。
3. 流動負債增加主要係應付工程及設備款增加 590,425 仟元。
4. 非流動負債增加主要係長期借款增加 1,021,165 仟元及負債準備增加 177,539 仟元。
5. 負債總額增加主要係應付工程及設備款增加 590,425 仟元、長期借款增加 1,021,165 仟元及負債準備增加 177,539 仟元。

## 二、財務績效

### 1.最近二年度經營結果分析

國際財務報導準則：

單位：新台幣仟元

項目	年度	114 年度	113 年度	增減金額	變動比例 (%)
營業收入淨額		7,238,545	7,059,941	178,604	2.53
營業成本		5,253,823	4,567,013	686,810	15.04
營業毛利		1,984,722	2,492,928	(508,206)	(20.39)
營業費用		507,834	597,440	(89,606)	(15.00)
其他營業收益及費損淨額		114,183	80,215	33,968	42.35
營業淨利		1,591,071	1,975,703	(384,632)	(19.47)
營業外收入及支出		(26,076)	84,671	(110,747)	(130.80)
稅前淨利		1,564,995	2,060,374	(495,379)	(24.04)
所得稅費用		211,462	390,654	(179,192)	(45.87)
稅後淨利		1,353,533	1,669,720	(316,187)	(18.94)

說明：(變動達 20%以上者)：

- 1.營業毛利及稅前淨利減少主要係高毛利 DOE 訂單大減，以及新廠建置測試產線的初期高額擴廠成本影響。
- 2.其他營業收益及費損淨額增加主要係處分不動產、廠房及設備淨額增加 34,789 仟元。
- 3.營業外收入及支出減少主要外幣兌換損益減少 115,850 仟元及透過損益按公允價值衡量之金融工具淨損減少 7,266 仟元、利息費用增加 19,253 仟元、利息收入增加 11,412 仟元及其他收入增加 5,678 仟元。
- 4.所得稅費用減少主要係稅前淨利減少及 114 年度新廠擴建與研發的大額資本支出產生未分配盈餘稅的抵減。

### 2.預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務可能影響及因應計劃

本公司長期致力於開發新型態之各類感測器之晶圓級封裝及後護層技術。12吋方面，2025年CIS晶圓級封裝逐步切入到車用、擴增實境(AR)、虛擬實踐(VR)等市場，同時往系統級封裝(SiP)或客製化需求開發邁進，目前有數家穿戴裝置相關元件客戶，因WLCSP適合輕薄短小的特性與精材客製化的技術服務能力，已展開新的專案，期望在2028年可以有初步成果。

DIGITIMES統計，2025年OSAT產業營收成長率突破11.6%，重要OSAT廠商亦多達到二位數的年成長率，主要受惠於川普對等關稅政策帶動全球電子供應鏈積極拉貨，晶片封測需求暢旺。展望2026年，OSAT產業營收預計仍將維持二位數的年成長率，下游AI產品如AI PC、GPU、CPU、AI加速器封測訂單對OSAT產業的營收影響將更為顯著，先進封裝技術亦將成為影響各大廠商競爭力的關鍵因

素。但仍需注意記憶體價格飆漲對消費性電子銷量、AI硬體建置成本的負面影響，進而拖累產業2026年營收成長。

未來本公司仍積極與策略客戶合作，共同開發創新技術，拓展消費性產品，行動裝置，車用電子，工業及醫療市場應用。其中車用電子產品、工業及醫療產品具有高技術門檻、較長的产品生命週期及營收與毛利穩定等特性，本公司將持續擴大與客戶的合作項目。

### 三、現金流量

#### (一) 最近一年度流動性分析

單位：新台幣仟元

項目	年度	114 年度	113 年度	增 ( 減 ) 金 額	變 動 比 例 ( % )
營業活動		1,865,575	2,138,696	(273,121)	(12.77)
投資活動		(2,829,548)	(1,441,994)	(1,387,554)	96.22
籌資活動		282,361	619,030	(336,669)	(54.39)
合 計		(681,612)	1,315,732	(1,997,344)	(151.80)
1. 本期營業活動之淨現金流入較上期減少，主要係本期稅前淨利減少 495,379 仟元、折舊費用增加 380,398 仟元、應收關係人款項淨變動增加 342,840 仟元及支付所得稅減少 177,375 仟元。 2. 本期投資活動之淨現金流出較上期增加，主要係資本支出增加 1,430,303 仟元。 3. 本期籌資活動之淨現金流入較上期減少，主要係舉借長期借款減少 181,000 仟元及發放現金股利增加 135,683 仟元。					

#### (二) 流動性不足之改善計畫

本公司資金需求將以自有資金及銀行借款支應，尚無流動性不足之疑慮。

#### (三) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額(1)	預計全年來自 營業活動淨現 金流量(2)	預計全年現 金流出量(3)	預計現金 剩餘(不足) 之數額 (1)+(2)-(3)	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	籌資計劃
4,354,085	3,026,972	(3,804,100)	3,576,957	—	銀行借款
1. 未來一年度現金流量變動情形分析： (1) 營業活動淨現金流入主要來自於營業收現。 (2) 現金流出主要係資本支出、發放現金股利並扣除舉借之長期借款。 2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：以銀行借款因應。					

#### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

114 年度資本支出主要係用於擴建新廠辦大樓、測試服務之廠務設施及研發機台，本公司係以自有資金及銀行借款支應，故對本公司之財務業務應無重大不利之影響。

#### 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：無。

#### 六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項

##### (一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施。

###### 1. 利率變動風險方面：

本公司之中期銀行借款利率係採浮動利率，利率變動將會影響未來現金流量，但不影響公允價值。本公司將持續關注利率變化，或向銀行承作利率交換交易，以規避利率波動之風險，降低融資成本之不確定性。

###### 2. 匯率變動風險方面：

本公司營運活動主要係以外幣進行交易，因此產生外幣匯率風險。為避免因匯率變動造成外幣資產價值下跌及未來現金流量之波動，本公司使用遠期外匯合約等衍生金融工具來規避匯率風險。此類衍生金融工具之使用，可協助本公司減少但仍無法完全排除外幣匯率變動所造成之影響。

###### 3. 通貨膨脹風險方面：

本公司除密切掌握原物料供需狀況，積極尋求兼具品質和價格競爭力的替代來源外，並致力於庫存管理、製程改良、良率改善及效率提升的成本縮減活動，以減少物價上漲的影響。

##### (二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司最近年度並未從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人及背書保證之情形。本公司所從事之衍生性商品交易主要為規避外幣資產及負債之匯率風險。為了控管財務交易風險，本公司已依據相關法令及規定，訂定了以健全財務及營運為基礎的內部管理辦法及作業程序。這些管理辦法包括「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」以及「取得或處分資產處理程序」(包括衍生性商品交易處理程序)。

##### (三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

因應市場及客戶對感應器的需求，持續提供新一代改良矽穿孔封裝(TSV CSP)、三維晶片封裝技術(3D IC package)等晶圓級封裝技術在各式感測器元件的應用，並以創新之晶圓級封裝技術服務將產品線擴展至微機電(MEMS)、功率場效電晶體、電源控制及類比元件等產品，以 12 吋產品線為主軸，與前段先進製程接軌，提供先進封裝服務。115 年度預計投入之研發費用為新台幣

365,203 仟元。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司的經營團隊一直密切注意任何可能會影響公司業務及營運的政策與法令。114 年相關法令的變化對本公司的營運並無重大影響。

(五) 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司的經營團隊一直密切注意任何科技改變及產業變化之相關訊息及趨勢，未來也積極投入研發以提昇競爭力；同時本公司亦會持續推動資通安全相關計畫，降低資通安全風險，以達持續營運之目標。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司參加櫃買中心舉辦之公司治理評鑑結果，除 111 及 113 年列於 6%~10%外，105 年至 112 年均列於前 5%。

為有效管理企業形象，本公司重視災害發生時的緊急應變準備(例如：颱風、地震、環境污染、資訊系統服務中斷、罷工、原物料或水電氣公用設施短缺等天然或人為災難)，並建立周全的應變計畫，包括在災難發生時成立專案應變小組的流程與步驟。本公司常設緊急應變中心，並 24 小時駐有值班人員，即時因應各種可能造成環境污染緊急事故，有利於在環境事故初期啟動應變機制、採取應變措施，抑制並防止故災害持續擴大，降低事故嚴重程度。另外，本公司訂有緊急應變管理程序，其中涵蓋空氣污染、氣體或化學物質洩漏等環境污染事件應變流程，並每年制訂緊急應變演練計畫，採用實兵推演方式由單位主管擔任指揮官執行緊急應變演練，透過實際演練強化應變小組應變量能。整合各廠區相關單位進行緊急應變定期演練並持續改善通報及運作程序，以確保危機處理時與利害關係人的溝通管道暢通，並統一由發言人對外代表發言。本公司截至年報刊印日止並無重大影響正常營運及企業形象的風險事項發生。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：請參閱本年報第 81 頁。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司儘可能向不同供應商採購原物料，以確保原物料供應無虞，並降低集中採購風險。雖然本公司仍有從單一供應商取得部份原物料之情形，但本公司仍將持續找尋其他購買方式以降低購買集中的風險。

114 年度最大客戶台積電集團佔本公司銷貨淨額為 74%，本公司未來將積極開發新市場及新客戶，並與原有客戶保持良好的合作關係，持續降低風險。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險及因應措施：

現有股東所持有本公司股票之價格可能會因大股東出售持股而受影響。台積公司仍是本公司最大股東，持有約 41%股權。台積公司將持續在影像感測元件與微機電系統及測試服務等領域與本公司保持密切合作。

(十一) 經營權之改變對公司之影響及風險：無。

(十二) 訴訟或非訟事件：

1. 公司最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉案當事人及目前處理情形：

(1) 訴訟事件：無。

(2) 非訟或行政爭訟事件：無。

2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：

本公司董事台灣積體電路製造股份有限公司(以下簡稱台積公司)最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件如下：

如半導體產業其他多數公司常見的情形，台積公司不定期會接獲第三人的通知，主張台積公司的技術、製程或台積公司製造之半導體產品的設計或客戶之使用，有侵害他人專利或其他智慧財產權之虞。這些主張有時導致雙方間的訴訟(台積公司或為原告或為被告)及台積公司支付和解金。無論這些第三人主張是否於法有據，或多或少可能造成台積公司訴訟費用之負擔或可能對公司之營運造成不利之影響。此外，台積公司亦須遵守相關地競爭法的規範並受到主管機關之監理，該等競爭法主管機關對台積公司發動之執法程序若其結果對台積公司不利，可能會損害台積公司之業務或影響台積公司之營運策略，從而對台積公司營運成果或展望造成負面影響，並使台積公司面臨潛在高度法律責任。

目前台積公司重大的法律事件如下：

Longitude Licensing Ltd.及 Marlin Semiconductor Limited (合稱“Marlin”)於民國一百一十四年二月，在美國國際貿易委員會(ITC)及美國東德州地方法院對台積公司及其客戶就五件美國專利提起專利權侵害調查及訴訟，ITC業於民國一百一十四年三月二十一日立案，東德州地方法院則於民國一百一十四年四月二十三日因ITC調查案繫屬中依法令規定暫停訴訟程序。本公司尚無法預知訴訟或調查結果且無法可靠估計該或有負債。

除前述法律案件之外，截至年報刊印日止，並無其他台積公司為案件主體的重大法律案件。

上述董事-台積公司之訟訴事件係屬法人董事之商業行為所致，且與本公司並無關係，故對本公司股東權益或證券價格並無重大影響。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

## 陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止，發生證交法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

精材科技股份有限公司



負 責 人：陳 家 湘

